

電子機器トータル ソリューション展

The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment

JPCA 2016
Show

第46回国際電子回路産業展
主催：一般社団法人日本電子回路工業会
Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association



2016
マイクロエレクトロニクスショー

第30回 最先端実装技術・パッケージング展
主催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会 (JIEP)
Sponsored by: Japan Institute of Electronics Packaging



**JISSO
PROTEC 2016**

第18回 実装プロセステクノロジー展
主催：一般社団法人日本ロボット工業会
Sponsored by: Japan Robot Association (JARA)



ラージエレクトロニクスショー-2016

共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電子デバイス産業新聞(産業タイムズ社)
Co-Sponsored by:
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
Electronic Device Industry News (Sangyo Times, Inc.)



**WIRE Japan Show
2016**

電線・ケーブル・コネクタ総合技術展
共催：一般社団法人日本電子回路工業会・電線新聞((株)工業通信)

結果報告書

2016 **6.1** WED. ▶ **6.3** FRI. 10:00-17:00

東京ビッグサイト Tokyo Big Sight, Japan

www.jpccashow.com

展示会本部事務局 **JPCA** 一般社団法人日本電子回路工業会

本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会

〒167-0042 東京都杉並区西荻北 3-12-2 回路会館 2F TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpcca.org

展示会運営事務局：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン

〒105-8335 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpccashow@jtbcom.co.jp

ご挨拶

「電子機器トータルソリューション展2016 (JPCA Show / マイクロエレクトロニクスショー / JISSO PROTEC / ラージエレクトロニクスショー / WIRE Japan Show)」は、2016年6月1日(水)～3日(金)の3日間、東京ビッグサイトにて開催され、出展者数760社、出展小間数1,421小間と盛況裡に無事終了することができました。

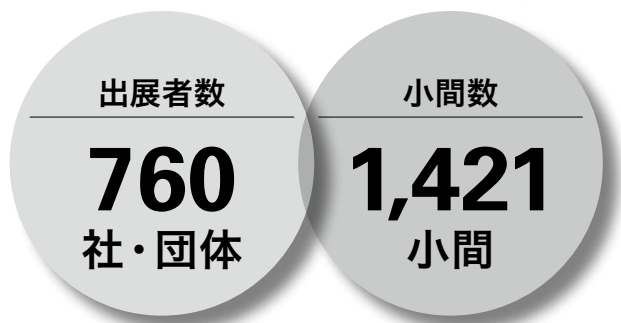
これもひとえに、ご後援を賜りました経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部をはじめ、協賛・特別協力団体各位、ご出展いただきました多くの企業の皆様のご支援とご協力の賜物と厚く御礼申し上げます。

次回開催は、2017年6月7日(水)～9日(金)「電子機器トータルソリューション展2017」を予定しておりますので、ご出展・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

ここに、今回の結果を取りまとめてご報告申し上げますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。

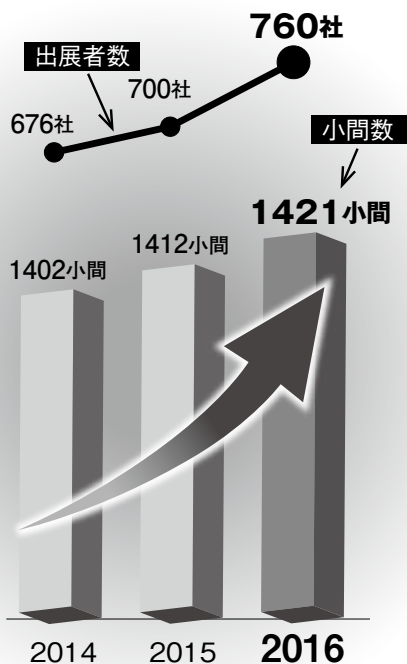
開催 TOPICS ①：展示会結果概要

過去最大規模で開催!!



1) 過去3年の開催規模実績 (2014年～2016年)

年 度	2014	2015	2016
小 間 数	1,402	1,412	1,421
出 展 者 数	676	700	760
開 催 会 場	東京ビッグサイト	東京ビッグサイト	東京ビッグサイト



() は 昨 年 の 数 字

日程	天候	実登録者数
6月1日(水)	☁	13,204名 (12,908名)
6月2日(木)	☀	13,453名 (12,890名)
6月3日(金)	☀	13,771名 (13,072名)
合計		40,428名 (38,870名)

セミナー聴講者数(のべ)

11,502名

国内最大級のセミナーとして
11,000名以上の動員効果を
生み出しました!

VIP来場者数

4,033名

経営者層等のVIP来場者が
4,000名以上来場し、
商談をされました!

海外来場者数

1,296名

18か国/地域から
1,300名近くの来訪があり、
グローバルな展示会として
認知されています。

技術者来場

39.4%

来場者の39.4%が、高度な技術者
または設備・工場管理に従事しており、
新製品の開発等新たな活動の
範囲を広げることが可能です。

※ 研究・開発、生産技術・製造技術、設計、
設備・工場管理職種を対象

購入・導入権限者来場

約7割

来場者の約7割が製品購入・
技術導入に関与しており、
商談につながるコンタクトが
期待できます。



開催 TOPICS ②：地域支援 ①熊本地震義援金の実施 ②東日本大震災復興支援

2016年4月14日に発生した、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震以降、熊本県、大分県を中心に相次ぎ地震が発生し、大きな被害が出ていることを踏まえ、日本電子回路工業会は来場者・出展者に義援金の呼びかけを行いました。

義援金箱はホール入口・基調講演会場入り口に設置、3日間で募金いただいた義援金は熊本県に寄付をし、微力ながら復興支援を行いました。大分県に対しては、温泉地や観光地パンフレット配布等の支援を致しました。

また、2011年3月11日に発生した東日本大震災から5年という節目を迎える中、福島県観光物産交流協会にご協力をいただき、以下の企画を実施しました。



展示会場内における
福島県観光物産
コーナーの実施

ウェルカムレセプションでの
福島県産日本酒の
ふるまい

VIPラウンジでの
福島県産
お菓子の提供

開催 TOPICS ③：JPCA 賞 (アワード) を展示会場にて実施

JPCA 賞 (アワード) 選考委員会にて、厳正なる審査の上、第12回 JPCA 賞 (アワード) 受賞企業が下記の通り決定致しました。JPCA 賞 (アワード) は、JPCA Show 2016 他 4 展示会出展者による新製品・新技術紹介「出展者 (NPI) プレゼンテーション」参加企業の中から、応募のあった発表内容の『独創性 (独自性・オリジナリティ)』、『産業界での発展性・将来性』、『信頼性』、『時世の適合性』を審査基準として、東京理科大学越地特任教授 (委員長)、関東学院大学工学部物質生命科学科小岩教授 (副委員長) をはじめとする学術界、電子回路業界、専門誌編集者等有識者の方々が構成する JPCA 賞 (アワード) 選考委員会によって厳正な審議を行い、電子回路技術及び産業の進歩発展に顕著な製品・技術への表彰制度として 2005 年より実施し、今年で第12回を迎えました。第12回の受賞企業は14社19件の中から8件の製品・技術が選ばれました。

第12回 JPCA賞

設備状態監視のキーデバイスを担うプリント基板プロセスで実現した高感度エネルギーセンサ 株式会社デンソー

電子機器の小型化、高性能化に伴い実装基板における微細化や多層化といったニーズはますますその重要性を増してきている。また一方で、3次元実装を可能とする部品内蔵技術も実用化されてきているのが現状である。我々はこれらのニーズに応えるべく高信頼性が要求される車載環境下でも使用可能な一括積層基板 (PALAP) を開発して、実用化に至っている。PALAP 技術の本質は「熱可塑性樹脂を圧力媒体とする粉末冶金技術」であり、それをうまく活用することで、従来にはない「薄く小型で高感度なエネルギーセンサ」を新たに開発し、RAFESPA ブランドとして発売を開始した。本センサは様々な分野にて広く活用可能だが、今回は非常に高感度で熱エネルギーを検知可能な点に着目し、設備 (装置) の状態監視、並びに今後の IoT 分野への適用可能性についても簡単に報告。

極薄 FPCビルドアップ用フレキシブル樹脂付き銅箔 Felios FRCC 『R-FR10』 パナソニック株式会社

スマートフォン等に用いられる FPC 基板の極薄多層化を目的として、フレキシブル樹脂付き銅箔 (Felios FRCC) を開発した。フレキシブルかつ多層成型後の表面平滑性に優れた熱硬化性樹脂を有し、従来工法では困難であった4層リジッドフレックス基板で厚み0.2mm以下、ビルドアップ工数半減を達成。

L/S=2/2μmの超微細回路形成および最終表面処理プロセス トップUFPプロセス 奥野製薬工業株式会社

パッケージ基板の微細配線化が進んでいる背景から、弊社ではL/S=2/2μmの超微細配線に適応した回路形成および最終表面処理プロセスとして「トップUFPプロセス」を開発した。今回、ナノ Ag 触媒を用いた無電解 Cu めっきプロセス、また最終表面処理である無電解 Pd/Au めっきプロセスの特長および性能について紹介。

低伝送損失基板を実現する低誘電・高接着ポリイミド樹脂「PIAD」 荒川化学工業株式会社

当社が開発した溶剤可溶性ポリイミド樹脂「PIAD」は、低誘電特性、高耐熱性、平滑な銅箔への高接着性を特徴としており、低伝送損失が求められる高周波基板向け接着剤成分として有用と考えられる。本発表では樹脂及び接着剤特性を説明すると共に、当接着剤を用いた基板の、伝送損失評価について紹介。

次世代高周波対応新規低伝送損失・低熱膨張多層材料 MCL-HS100 日立化成株式会社

近年、データ伝送の高速化・大容量化が急速に進むにつれ、プリント配線板材料において更なる低伝送損失材料への要求が高まってきている。それに伴い、PKG 材料においても低伝送損失が求められるようになってきており、サーバやモジュール用途の基材に向けて開発を行った。

最新の蛍光 X線膜厚計によるめっき厚測定と微細パターンを持つ電子回路基板への適用 株式会社日立ハイテクサイエンス

近年、プリント基板など電子部品では50μmを下回るような微細領域や10nm程度の厚さに対する測定が求められています。最新モデルFT150シリーズでは、より高精度・高スループットな測定と操作性向上を実現しました。本シリーズの特長とアプリケーションについて紹介。

JPCA 奨励賞

環境対応・高機能型 ほう素フリースルファミン酸ニッケルめっき薬品 日本化学産業株式会社

ほう素排水規制の抜本的対策。環境対応・高機能型ニッケルめっき薬品を提供。従来のほう酸浴に遜色がない皮膜物性。浴組成管理と排水処理が容易で、導入時の設備改修も不要。皮膜の機械的強度を、作業条件で任意に管理可能。高速めっきや低温めっき等の用途毎に機能を向上させた改良タイプも用意しました。

熱設計のパラダイムシフトに対応するために KOA 株式会社

近年、電子部品の表面実装化と小型化に伴い、部品の放熱経路が大気放熱形から基板放熱形に変化しており、熱設計手法も大きな転換点を迎えている。表面実装部品の使用温度に関する定格のあるべき姿を示し、サーマルマネジメントに欠かせない温度測定時の落とし穴について注意を喚起するとともに対策を提案。



開催 TOPICS ④：業界のリーダーが集う式典を実施

開会式 電子機器トータルソリューション展 開幕!!

経済産業省、海外協力団体及び主催・共催団体18名によるテープカットが行われた。

●日 時：6月1日(水) 9:30～10:00

●会 場：東京ビッグサイト 北コンコース メインボード前

御来賓	三浦 章豪	経済産業省 商務情報政策局	情報通信機器課長
開催挨拶	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
登壇者	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	岩城 慶太郎	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	佐藤 英志	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	白石 洋一	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長
	猪川 幸司	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	展示委員長
	青田 広幸	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
	太田 裕之	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2016 運営委員会委員長
	須原 信介	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2016 運営委員会曾我信之委員代理
	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長
	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
	You Lei	中国印刷電路行業協會 (CPCA)	Chairman
	Michael Weinhold	欧州電子回路協會 (EIPC)	Technical Director
	Rick Wu	台湾電路板協會 (TPCA)	Chairman
	KyungHee, KIM	韓国電子回路産業協會 (KPCA)	Chairman
	WC Pang	香港線路板協會 (HKPCA)	Subcom Chairman

ウェルカムレセプション

出展企業および業界関係者800名の参加を得て開催。御来賓として経済産業省鈴木淳司副大臣にご挨拶をいただいた。

●日 時：6月1日(水) 17:30～19:30

●会 場：東京ビッグサイト レセプションホール

挨拶/乾杯登壇	鈴木 淳司	経済産業省	副大臣
開催挨拶	白石 洋一	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	副会長
乾杯発声	井上 政基	株式会社工業通信	代表取締役社長
中締挨拶	青田 広幸	一般社団法人日本ロボット工業会	副会長
乾杯登壇	小林 俊文	一般社団法人日本電子回路工業会	会長
	山本 治彦	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	山下 博樹	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	岩城 慶太郎	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	佐藤 英志	一般社団法人日本電子回路工業会	副会長
	猪川 幸司	一般社団法人エレクトロニクス実装学会	展示委員長
	太田 裕之	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2016 運営委員会委員長
	須原 信介	一般社団法人日本ロボット工業会	JISSO PROTEC 2016 運営委員会曾我信之委員代理
	泉谷 渉	株式会社産業タイムズ社	代表取締役社長



1.実施概要



(一社)日本電子回路工業会
会長 小林俊文



展示会運営委員会
委員長 山本治彦



(一社)エレクトロニクス実装学会
会長 佐相秀幸



(一社)日本ロボット工業会
会長 津田純嗣



(株)産業タイムズ社
代表取締役社長 泉谷渉



(株)工業通信
代表取締役社長 井上政基

■ 会 期：2016年6月1日(水)～3日(金)

■ 開催時間：10:00～17:00

■ 会 場：東京ビッグサイト 東展示棟・東2～6ホール

■ 名 称：**JPCA Show 2016 第46回国際電子回路産業展**

主 催：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

構成展示会：2016プリント配線板技術展

2016半導体パッケージング・部品内蔵技術展

2016機器・半導体受託生産システム展

ものつくりフェスタ2016

JISSO PROTEC 2016 第18回実装プロセステクノロジー展

主 催：一般社団法人日本ロボット工業会

WIRE Japan Show 2016 電線・ケーブル・コネクタ総合技術展

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

電線新聞(株式会社工業通信)

2016マイクロエレクトロニクスショー 第30回最先端実装技術・パッケージング展

主 催：一般社団法人エレクトロニクス実装学会

ラージエレクトロニクスショー2016

共 催：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

電子デバイス産業新聞(株式会社産業タイムズ社)

構成展示会：2016プリントエレクトロニクス最適生産システム展

2016部品・MEMS/デバイス産業総合資材展

2016LED/OLED応用技術展

■ 後 援：経済産業省、独立行政法人中小企業基盤整備機構 関東本部

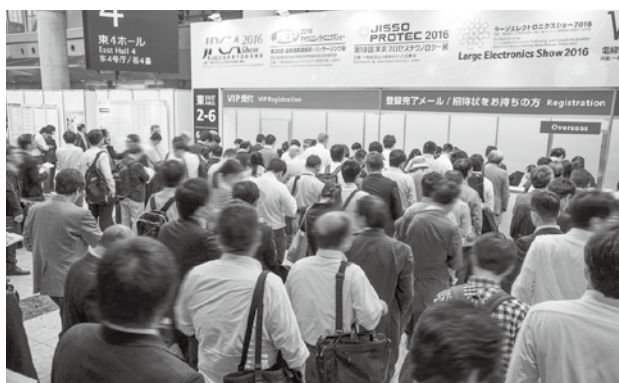
■ 特別協力：一般社団法人カメラ映像機器工業会(CIPA)、一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)、独立行政法人産業技術総合研究所、SEMIジャパン、一般社団法人日本銅センター(JCDA)、一般社団法人日本電子デバイス産業協会(NEDIA)、日本MID協会、日本品質保証機構(JQA)

■ 海外協力：世界電子回路業界団体協議会 加盟団体— **CPCA**-中国印制电路行業協會、 **EIPC**-欧州電子回路協会、**HKPCA**-香港線路板協會、**IPC**-米国電子回路協会、 **IEDA**-インド電子回路工業会、**KPCA**-韓国電子回路産業協會、**TPCA**-台湾電路板協會

■ 展示会本部事務局：一般社団法人日本電子回路工業会 JPCA

■ 協 賛：映像情報メディア学会、画像電子学会、カメラ映像機器工業会、自動車技術会、写真感光材料工業会、情報サービス産業協会、情報処理学会、全国鍍金工業組合連合会、電気安全環境研究所、電気学会、電気機能材料工業会、電気設備学会、電子情報技術産業協会、電子情報通信学会、銅箔工業会、日本アミューズメントマシン協会、日本医療機器工業会、日本医療機器テクノロジー協会、日本印刷産業連合会、日本オーディオ協会、日本音響学会、日本化学工業協会、日本火災報知機工業会、日本金型工業会、日本機械工業連合会、日本金属熱処理工業会、日本計量機器工業連合会、日本産業機械工業会、日本自動車研究所、日本自動車部品工業会、日本真空学会、日本真空工業会、日本精密測定機器工業会、日本セラミックス協会、日本電気協会、日本電気計測器工業会、日本電機工業会、日本電気制御機器工業会、日本照明工業会、日本電子部品信頼性センター、日本電線工業会、日本配線システム工業会、日本半導体製造装置協会、日本表面処理機材工業会、日本品質保証機構、日本ファインセラミックス協会、日本分析化学会、日本分析機器工業会、日本ベアリング工業会、日本遊技関連事業協会、日本溶接協会、光産業技術振興協会、ビジネス機械・情報システム産業協会、表面技術協会、ファインセラミックスセンター、組込みシステム技術協会、太陽光発電技術研究組合、次世代化学材料評価技術研究組合、技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、日本材料科学会、情報通信ネットワーク産業協会、コンピュータソフトウェア協会、プリントエレクトロニクス研究会

■ 展示会運営事務局：株式会社JTBコミュニケーションデザイン



東2ホール



PWB 電子回路プラザ

Table listing exhibitors for the PWB Electronics Circuit Plaza. Columns include booth number (小間番号) and company name (社名). Exhibitors include 株式会社エヌピーシー, 株式会社愛工機器製作所, 株式会社野田スクリーン, etc.

アカデミックプラザ

Table listing exhibitors for the Academic Plaza. Columns include booth number (小間番号) and company name (社名). Exhibitors include 東京大学 日暮研究室, 九州大学 ナノ・マイクロ工学研究室, etc.

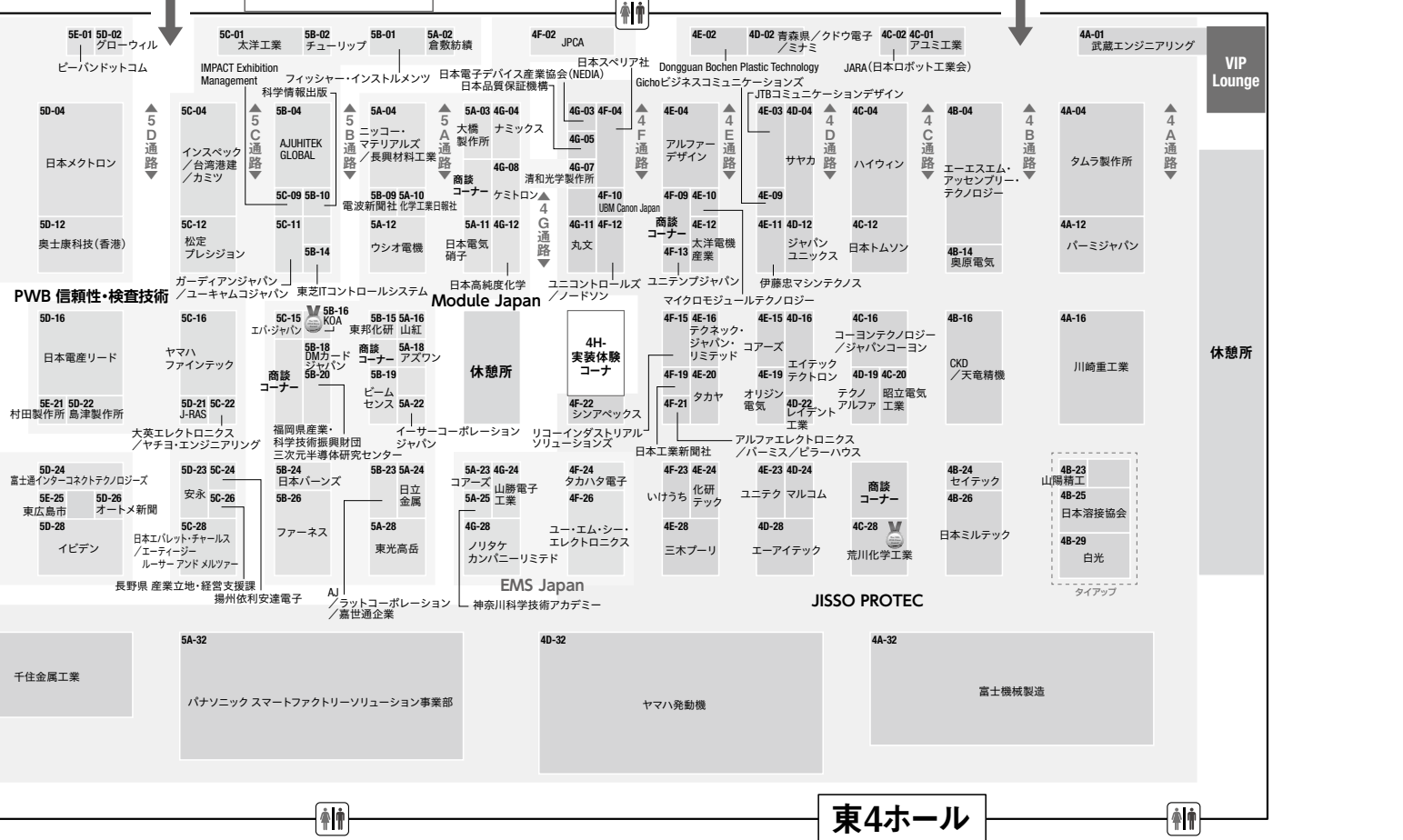
3D-MIDパビリオン

Table listing exhibitors for the 3D-MID Pavilion. Columns include booth number (小間番号) and company name (社名). Exhibitors include 日本MID協会, 日本MIDパビリオン株式会社, パナソニック株式会社, etc.

ex-tech

Table listing exhibitors for the ex-tech pavilion. Columns include booth number (小間番号) and company name (社名). Exhibitors include 味の素ファインテック株式会社, 東レエンジニアリング株式会社, ハリマ化成株式会社, etc.

5H-PROTEC会場



東4ホール

3. 出展者一覧

※五十音順

JPCA Show 2016

株式会社愛工機器製作所	6B-04	熊本県	2G-01	太洋工業株式会社	5C-01
IPCA (印度電子回路工業会)	6C-24	一般社団法人組込みシステム技術協会	5H-26	株式会社ダイワ	3A-28
株式会社アイン	6C-14	倉敷紡績株式会社	5A-02	株式会社ダイワ工業	6C-04
鉅橡企業股份有限公司	2G-03	クラレケミカル株式会社	5F-26	台湾港建股份有限公司	5C-04
奥土康科技 (香港) 有限公司	5D-12	株式会社グローウル	5D-02	TaeSung Co., Ltd.	5H-24
AJUHITEK GLOBAL 株式会社	5B-04	KPCA (韓国電子回路産業協会)	6C-23	株式会社高田工業所	2A-23
株式会社アスカエンジニアリング	5F-24	ケセル株式会社	3A-18	株式会社タカハタ電子	4F-24
アストロデザイン株式会社	5H-26	株式会社ケミロン	4G-08	株式会社タケウチ	3D-01
アズワン株式会社	5A-18	ケンマージャパン株式会社	2A-08	タツマ電線株式会社	2C-20
株式会社アドテックエンジニアリング	3B-18	株式会社コアーズ	5A-23	株式会社タムラ製作所	2D-33
アドテックジャパン株式会社	2B-34	興研株式会社	5G-25	千葉県	5F-18
アルテック株式会社	3B-09	KOA 株式会社	5B-16	China Circuit Technology (Shantou) Corporation	2G-07
アルメックスPE株式会社	3D-28	五応化学工業株式会社	2B-23	中小企業基盤整備機構	6B-10
EIPC (欧州電子回路協会)	6C-19	株式会社サマープレジジョン	3C-12	チュリップ株式会社	5B-02
イーサーコーポレーションジャパン	5A-22	サイバネットシステム株式会社	6A-04	長興材料工業股份有限公司	5A-04
株式会社イースタン	5F-07	相模ビーシーアイ株式会社	5G-20	超高効率電子回路生産システム研究会 (E-ESMAP)	5G-25
イープロニクス株式会社	3A-02	相模ビーシーアイ株式会社	6B-04	株式会社塚谷刃物製作所	2G-28
株式会社石井表記	3A-04	株式会社サトーセン	6C-13	株式会社角田プラン製作所	2B-20
石原ケミカル株式会社	2A-03	山栄化学株式会社	2B-17	ティーシーティー・ジャパン株式会社	2C-15
株式会社伊東電機工作所	3A-18	三共化成株式会社	3F-08-09	TPCA (台湾電路板協会)	6C-16
伊原電子工業株式会社	6B-14	産業技術総合研究所	6D-16	DMカードジャパン株式会社	5B-18
イビデン株式会社	5D-28	三共精密金型株式会社	3F-08-09	デュボン株式会社	2E-04
岩谷産業株式会社	5F-26	三協電精株式会社	6C-31-6	株式会社デンソー	5E-04
地方独立行政法人岩手県工業技術センター	3F-08-08	三晃技研工業株式会社	2E-24	株式会社電波新聞社	5B-09
Inkron Limited	3E-20	三晃技研工業株式会社	2G-33	東海神栄電子工業株式会社	6B-04
インスペック株式会社	5C-04	株式会社サンヨー工業	6C-12	東京応化工業株式会社	2F-12
IMPACT Exhibition Management Co., Ltd.	5C-09	サンワ化学工業株式会社	2B-24	東京化工機株式会社	2B-11
衛司特科技股份有限公司	3D-04	株式会社三和研究所	2A-02	東京マシン・アンド・ツール株式会社	2E-24
WECC (世界電子回路業界団体協議会)	6C-15	シエムケイ・プロダクツ株式会社	5F-04	東京マシン・アンド・ツール株式会社	3C-33
上村工業株式会社	2B-28	浙江華正新材料股份有限公司	3A-10	統合規格部会	6D-29
ウシオ電機株式会社	5A-12	CPCA (中国印制電路行業協会)	6C-27	東光技研工業株式会社	3A-12
梅田真空包装株式会社	6B-15	JX 金属株式会社	2E-12	株式会社東光高岳	5A-28
永旺株式会社	5G-28	株式会社JCU	2C-04	東芝ITコントロールシステム株式会社	5B-14
HKPCA (香港線路板協会)	6C-30	JPCA (日本電子回路工業会)	6B-28	東邦化研株式会社	5B-15
株式会社エイト工業	5G-15	JPCA 広報委員会	6B-29	東朋テクノロジー株式会社	3C-33
株式会社AJ	5B-23	JPCA 検定制度 PWB コンサルタント / PWB インストラクタ	6D-25	東レ・デュボン株式会社	2E-04
エーティージー ルーサー アンド メルツァー	5C-28	JPCA 友の会	6B-26	東レ・デュボン株式会社	3F-08-12
Express Electronics Limited	5E-24	J-RAS 株式会社	5D-21	東和プリント工業株式会社	5H-15
X&Y International Corporation Limited	2A-22	JADASON Enterprises Ltd.	2E-24	トーヨーケム株式会社	2E-08
NTW Inc. 株式会社	5F-16	SHENGYI TECHNOLOGY CO., LTD.	2D-08	ドローン体験コーナー	6C-31-4
株式会社エヌピーシー	6B-04	深圳市金洲精工科技股份有限公司	2G-12	東莞銘光磁股份有限公司	5E-16
エバ・ジャパン株式会社	5C-15	SHENZHEN SUNTAK CIRCUIT TECHNOLOGY CO., LTD.	5G-16	東台精機ジャパン株式会社	2G-24
エビナ電化工業株式会社	3F-08-07	深圳市騰鑫精密粘粘制品有限公司	2F-24	Tongtai Machine & Tool Co., Ltd.	2G-24
株式会社FPCコネク	6C-11	株式会社シグナス	5G-01	中島化学産業株式会社	2G-03
FPC MAKER SHENZHEN JMTH	5G-28	四国化成工業株式会社	2C-12	長瀬産業株式会社	3E-20
株式会社エフディコミュニケーション	6C-31-7	株式会社システムクラフト	5H-26	長野県 産業立地・経営支援課	5C-26
エポックサイエンス株式会社	5H-26	株式会社島津製作所	5D-22	ナミックス株式会社	4G-04
株式会社エム・シー・ケー	2G-08	株式会社ジャパンユニックス	3F-08-14	株式会社ニソール	5H-12
株式会社エリアデザイン	3B-15	ジャブプロ工業株式会社	2C-10	ニッカン工業株式会社	2F-19
LPKF Laser & Electronics 株式会社	3F-08-11	上海南亜覆銅箔有限公司	2F-15	日刊工業新聞社	2G-16
LPKF Laser & Electronics 株式会社	3F-11	奥素科学・環境フォーラム	2A-21	ニッコー・マテリアルズ株式会社	5A-04
エンズンガー・ジャパン株式会社	3F-08-16	珠海鎮東有限公司	5H-19	ニッタク株式会社	3B-21
株式会社オーク製作所	3B-12	シュモール マンネン	2G-33	株式会社日放電子	3D-10
株式会社オーケープリント	5G-29	昭光通商株式会社	2D-30	日本ゼオン株式会社	2A-24
大阪大学	3F-19	昭和電工株式会社	2D-32	日本電気硝子株式会社	5A-11
公益財団法人大田区産業振興協会	2A-28	ジョージフィッシャー株式会社	3B-23	日本ポリテック株式会社	2E-27
オート新聞株式会社	5D-26	ショータクトロン株式会社	3D-24	株式会社二宮システム	3B-01
株式会社大橋製作所	5A-03	スライ電子工業株式会社	3D-12	日本アグファマテリアルズ株式会社	2A-09
大船企業日本株式会社	3C-18	株式会社伸興	3D-02	日本エレクトロ・チャールズ株式会社	5C-28
オカダジーエージェイ株式会社	2C-24	株式会社伸光製作所	6C-14	日本 MID 協会	3F-08-01
オキツモ株式会社	5E-28	瑞華ハイテック電子工業 (厦門) 有限会社	5F-19	日本オルボテック株式会社	3B-04
沖電線株式会社	5F-20	株式会社SCREENグラフィックアンドプレジジョンソリューションズ	3C-24	日本化学産業株式会社	2B-07
沖縄県	3F-21	株式会社社研	3F-08-06	株式会社日本工業新聞社	4F-19
奥野製業工業株式会社	2C-24	ステイ電子機器株式会社	5G-23	日本高純度化学株式会社	4G-12
奥野製業工業株式会社	3F-08-17	ステラ株式会社	3C-33	株式会社日本サーキット	6C-31-2
ガーディアンジャパン株式会社	5C-11	株式会社ステラ・コーポレーション	5H-04	日本シエムケイ株式会社	5F-04
株式会社化学工業日報社	5A-10	株式会社ストラテジー	5H-26	日本テクノ株式会社	6B-16
科学情報出版株式会社	5B-10	Smart e-plating RLS, Sungkyunkwan University	2F-02	日本電産リド株式会社	5D-16
笠原理化工業株式会社	2B-01	住友重機械工業株式会社	3F-07	日本電子回路厚生年金基金	6B-24
公益財団法人神奈川科学技術アカデミー	5A-25	株式会社清和光学製作所	4G-07	日本バーカライジング株式会社	2G-11
株式会社カネカ	2F-30	SEMジャパン	6A-16	日本バーンス株式会社	5B-24
株式会社カミツ	5C-04	株式会社セラリアコーポレーション	3D-18	日本マクダーミッド株式会社	2A-12
カワムラ精機株式会社	2G-04	双日プラネット株式会社	2D-08	日本マクダーミッド株式会社	3F-08-02
環境安全委員会	6D-23	有限会社双明通信機製作所	5H-01	日本ミクロン株式会社	6C-06
北川精機株式会社	3E-04	株式会社Sohwa & Sophia Technologies	5H-26	日本メクトロン株式会社	5D-04
嘉世通企業有限公司	5B-23	株式会社ソフックス	3A-03	日本モレックス合同会社	3F-08-05
キャノンテック株式会社	3A-24	ソマル株式会社	2A-30	株式会社野田スクリーン	5F-21
Qdos テクノロジー	5F-19	嵩台資訊股份有限公司	3D-04	株式会社野田スクリーン	6B-04
協栄二業エンジニアリング株式会社	5G-04	大英エレクトロニクス株式会社	3F-08-13	NovaCentrix	2D-30
協栄プリント技研株式会社	2B-10	大英エレクトロニクス株式会社	5C-22	株式会社リタテカバンニョリミテド	4G-28
株式会社京写	5F-30	台強電機股份有限公司	3F-17	Park Electrochemical Corp.	3E-12
King board Laminates Holdings Limited	5E-24	大道産業株式会社	3A-18	伯東株式会社	3B-24
邦田工業株式会社	6B-04	ダイナトロン株式会社	2E-33	PacTech - Packaging Technologies GmbH	3E-20
		ダイナトロン株式会社	2D-20	八光電子工業株式会社	6C-05
		太陽インキ製造株式会社	2C-12	パナソニック株式会社	2D-24

パナソニック株式会社	3F-08-03
PAN-TEC CORPORATION LIMITED	2E-24
ピアメカニクス株式会社	3C-33
株式会社ビーエムティー	6C-31-5
株式会社ビーバンドコム	5E-01
株式会社ビームセンス	5B-19
東広島市	5E-25
Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd.	5E-12
日立化成株式会社	2D-12
日立化成商事株式会社	2D-12
日立化成商事株式会社	3C-33
日立金属株式会社	5A-24
株式会社日立ハイテクサイエンス	5E-08
株式会社日立ハイテクノロジーズ	3E-08
株式会社平山ファインテクノ	5F-02
ヒロセ電機株式会社	5F-32
株式会社ファース	5B-26
株式会社ファインテック	3E-02
和仁貿易	2E-24
株式会社フィッシャー・インストルメンツ	5B-01
フェイス株式会社	5H-01
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団	5B-20
三次元半導体研究センター	
福島県観光物産コーナー	5G-08
福岡大学	5G-25
福田金属箔粉工業株式会社	2F-08
福電資材株式会社	6C-31-3
富士機械製造株式会社	3F-08-04
株式会社フジ精工	3B-02
富士通インターコネクテクトロジーズ株式会社	5D-24
富士回路科技	5H-01
富士プリント工業株式会社	5H-01
PRAMURA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	6B-01
株式会社プリマックス	3A-12
株式会社プリント回路ジャーナル	2C-28
プリント配線板技術ロードマップ	6D-27
株式会社ブルックスジャパン	3F-11
株式会社ベアック	3C-30
康源電子厂有限公司	5E-20
マイクロクラフト株式会社	3C-04
松定プレジジョン株式会社	5C-12
松田産業株式会社	2A-04
株式会社丸源鉄工所	3D-04
三井金属鉱業株式会社	2E-18
三菱ガス化学株式会社	2D-04
三菱電機株式会社	3A-33
ミニインターナショナル株式会社	3A-16
株式会社ミノグループ	3A-16
株式会社村上電子工学	6C-11
株式会社ムラキ	3C-29
株式会社ムラタ	2A-02
株式会社村田製作所	5E-21
名東電産株式会社	6B-04
メック株式会社	2C-30
株式会社メディアテクノロジージャパン	3C-24
株式会社メルシー	6F-23
メルテックス株式会社	2B-12
株式会社モトロニクス	3A-12
森村商事株式会社	2A-02
株式会社安永	5D-23
株式会社ヤチヨ・エンジニアリング	5C-22
藪内産業株式会社	3E-16
山勝電子工業株式会社	4G-24
山下マテリアル株式会社	5E-28
ヤマハ発動機株式会社	3F-08-10
ヤマハファインテック株式会社	5C-16
有限会社山紅	5A-16
揚州依利安達電子有限公司	5C-24
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社	4F-26
ユーキャムコジャパン	5C-11
ユニオン ツール株式会社	2E-24
ユニクラフト株式会社	3A-02
ユニチカ株式会社	2F-04
米沢ダイヤエレクトロニクス株式会社	2D-04
株式会社ライズエレクトロニクス	5E-24
株式会社ラットコーポレーション	5B-23
Rappa 株式会社	6C-31-1
利昌工業株式会社	2E-02
RITAエレクトロニクス株式会社	6B-12
リックス株式会社	3F-01
鷹潭江南銅業有限公司	2G-15
株式会社レヨーン工業	3B-30
連結機械股份有限公司	3E-02
ロム・アンド・ハース電子材料株式会社(ダウ・ケミカルグループ)	2B-04
ロム・アンド・ハース電子材料株式会社(ダウ・ケミカルグループ)	3F-08-15
碌々産業株式会社	3A-23
株式会社ロゼッタ	6A-30
株式会社ワールドケミカル	2A-11
WorldTect	3A-09
ワイエステクノ株式会社	5F-19

2016マイクロエレクトロニクスショー	
味の素ファインテクノ株式会社	6E-16
アテネ株式会社	6F-17
イーエムテクノロジーズ株式会社	6E-24
株式会社ウェル テストウェア営業部	6F-21
株式会社ウェル プラズマ装置営業部	6F-25
エクストコム株式会社	6F-06
株式会社SIJテクノロジー	6F-16
SSI Japan株式会社	6H-13
エスベック株式会社	6H-15
地方独立行政法人大阪市立工業研究所	6H-10
大阪府立大学 工学研究科 応用化学分野	6H-12
分子認識化学研究グループ	
株式会社岡本工作機械製作所	6G-15
沖エンジンアリング株式会社	6H-03
関東学院大学 理工学部 化学学系 小岩研究室	6H-03
関東学院大学 理工学部 化学学系 小岩研究室	6H-04
関東学院大学 理工学部 化学学系 小岩研究室	6H-05
関東学院大学 理工学部 化学学系 小岩研究室	6H-06
関東学院大学 材料・表面工学研究所	6H-08
九州大学 大学院 システム情報科学研究院	
情報エレクトロニクス部門 金谷研究室	6F-08
九州大学 大学院システム生命科学府	
ナノ・マイクロ工医学研究室	6F-06
グリーンケム株式会社	6H-12
群馬工業高等専門学校 機械工学科	
材料デザイン研究室	6G-11
群馬大学 先端科学研究指導者育成ユニット	
井上研究室	6G-09
群馬大学大学院 理工学府	
知能機械創製理工学領域 白石研究室	6G-10
株式会社ケトックス	6G-13
神戸大学大学院理学研究科 木村研究室	6G-07
悟空株式会社	6G-16
サムテック有限会社	6H-17
産業技術総合研究所	6E-22
JIEP (エレクトロニクス実装学会)	6G-01
シーマ電子株式会社	6H-18
芝浦工業大学エネルギー物性研究室	6I-11
Shimada Appli 合同会社	6F-15
信州大学 工学部 電子情報システム工学科	
先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室・宮地研究室	6G-03
信州大学 工学部 電子情報システム工学科	
先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室	6G-05
信州大学 先端磁気デバイス(佐藤・曾根原)研究室	6G-06
スピンドバイステクノロジーセンター	6G-06
チップワークス株式会社	6G-17
電気通信大学産学官連携センター ギガビット研究会	6I-09
電気通信大学大学院情報理工学研究所 肖研究室	6I-09
東京工芸大学 工学部 電子機械学科 越地研究室	6I-07
東京大学 大学院工学系研究科 精密工学専攻	6F-04
日暮研究室	
東京大学 実装工学分野研究室	6F-06
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター	6H-09
同志社大学 理工学部	6H-12
同志社大学 理工学部 機械系学科	
生産システムデザイン研究室	6F-12
東北大学 学際科学フロンティア研究所 島津研究室	6G-08
東レエンジニアリング株式会社	6E-18
長野県工業技術総合センター 精密・電子技術部門	6G-05
長野工業高等専門学校 中山研究室	6G-04
長野工業高等専門学校 中山研究室	6G-06
日本大学理工学部 精密機械工学科	
マイクロデザイン研究室	6I-03
ハニー化成株式会社	6G-14
ハリマ化成株式会社	6E-20
株式会社バリウアップシステムズ	6G-10
株式会社日立パワーソリューションズ	6H-14
兵庫県立大学 工学部	6F-12
フォトエレクトロニクス株式会社	6H-04
福岡県工業技術センター 化学繊維研究所	6H-11
藤倉化成株式会社	6H-16
富士通クオリティ・ラボ株式会社	6F-18
株式会社プラスマイオンアシスト	6F-19
株式会社プラムファイブ	6G-18
ミドリ電子株式会社	6G-05
明治大学理工学部機械工学科計測情報研究室	6F-14
山口東京理科大学工学部機械工学科	6I-05
横浜国立大学大学院工学研究科 機能発現工学専攻 物質とエネルギーの創生工学コース	6G-12
ヨシモトボール株式会社	6G-10
株式会社リアライズコンピュータエンジニアリング	6G-10
龍谷大学 理工学部 機械システム工学科	
小川研究室	6F-12
早稲田大学 情報生産システム研究センター	
巽研究室	6H-07
早稲田大学 理工学研究所	6H-05
早稲田大学 理工学術院 門間研究室	6H-05

JISSO PROTEC 2016	
青森県	4D-02
アユミ工業株式会社	4C-01
荒川化学工業株式会社	4C-28
アルファデザイン株式会社	4E-04
アルファエレクトロニクス株式会社	4F-21
株式会社いけうち	4E-23
伊藤忠マシントクノス株式会社	4E-11
エイテックテクトロニクス株式会社	4D-16
株式会社イーアイテック	4D-28
エーエスエム・アッセンブリー・テクノロジー株式会社	4B-04
奥原電気株式会社	4B-14
オリジン電気株式会社	4E-19
化研テック株式会社	4E-24
川崎重工工業株式会社	4A-16
Gichoビジネスコミュニケーションズ株式会社	4E-09
有限会社クドウ電子	4D-02
株式会社コアース	4E-15
株式会社コロンテクノロジー	4C-16
株式会社サヤカ	4D-04
山陽精工株式会社	4B-23
CKD 株式会社	4B-16
ジャパンコーン株式会社	4C-16
株式会社ジャパンユニックス	4D-12
JARA (日本ロボット工業)	4C-02
昭立電気工業株式会社	4C-20
株式会社シンアベックス	4F-22
セイテック株式会社	4B-24
千住金属工業株式会社	5D-32
太平洋電機産業株式会社	4E-12
タカヤ株式会社	4E-20
株式会社タムラ製作所	4A-04
テックネット・ジャパン・リミテッド	4E-16
テクノアルファ株式会社	4D-19
天竜精機株式会社	4B-16
Dongguan Bochen Plastic Technology CO., LTD.	4E-02
一般社団法人日本電子デバイス産業協会 (NEDIA)	4G-03
日本トムソン株式会社	4C-12
株式会社日本スベリア社	4F-04
一般財団法人日本品質保証機構	4G-05
日本ミルテック株式会社	4B-26
一般社団法人日本溶接協会	4B-25
ノードン株式会社	4F-12
バーミジャパン株式会社	4A-12
バーミス	4F-21
ハイウィン株式会社	4C-04
白光株式会社	4B-29
パナソニック株式会社 スマートファクトリーソリューション事業部	5A-32
ピラーハウス	4F-21
富士機械製造株式会社	4A-32
マイクロモジュールテクノロジー株式会社	4E-10
株式会社マルコム	4D-24
丸文株式会社	4G-11
三木ブリー株式会社	4E-28
株式会社ミナミ	4D-02
武蔵エンジニアリング株式会社	4A-01
ヤマハ発動機株式会社	4D-32
UBM Canon Japan 合同会社	4F-10
ユニコントロールズ株式会社	4F-12
ユニテック株式会社	4E-23
ユニテックジャパン株式会社	4F-13
リコーインダストリアルソリューションズ株式会社	4F-15
レイデント工業株式会社	4D-22

ラージエレクトロニクスショー2016	
アサダメッシュ株式会社	6D-04
株式会社SPIエンジニアリング	6E-13
株式会社サクラクレパス	6D-14
株式会社産業タイムズ社	6E-03
日刊工業新聞社	6E-05

WIRE Japan Show 2016	
株式会社インコム	6E-12
キヤノン電子株式会社	6E-14
株式会社工業通信	6E-02
株式会社ササキ	6F-01
東新セラテック株式会社	6F-07
日本マルコム株式会社	6F-03
バンドウィットコーポレーション日本支社	6E-04
株式会社ロコムジャパン	6F-11
YFC-BonEagle ELECTRIC CO., LTD.	6E-08

4. 基調講演・特別パネルディスカッション 有料 VIP無料 3H-基調講演会場

●聴講者数：全12セッション 1,999名(前回実績：2,692名)

6月1日(水)	10:30 11:15	基調講演 English/同時通訳  Shaping the future - Festo Bionic Learning Network & Industry 4.0 in practice Harry Vuksanovic Festo Asia Pacific Head of Electronics & Assembly Segment	What do the Festo projects of Bionic Learning Network and Industry 4.0 have in common? What inspirations from these concepts we can learn and bring into future practice, when the manufacturers of electronics industries are nowadays often under enormous pressure to bring devices to the market in less than 12 months and design equipment very fast? In shaping the production of the future, Festo is strategically concentrating on a triad comprising new technologies, state-of-the-art training and further education, and the human at the focus of attention. Festo is willing to share some more insights from various perspectives with you at JPCA Keynote Speech.
	11:30 12:15	基調講演 English/同時通訳  The Future of Bio-sensing in Healthcare Harry Gandhi Medella Health Co-founder	We live in a reactive model of care, where we go to the healthcare provider only when things go wrong (and usually when it's too late). Although we've seen great research on the clinical side, our global healthcare system has only grown incrementally and is far from pro-active. The solution to preventative medicine lies in the data we are able to collect from our patients. With the growth of electronics and nanotechnology, a preventative system is now possible with the vast range of sensors that can be integrated into an everyday life.
	13:00 13:45	基調講演  MIDの紹介と日本MID協会について 鈴木 誠司 日本MID協会 代表幹事	MID概要、歴史と代表的な技術、用途をご紹介。並びに日本MID協会の概要と活動内容をご紹介します。
14:00 15:30	特別パネルディスカッション 前線で輝く女性リーダー達		
6月2日(木)	10:30 11:15	基調講演  CPS時代の到来! 無限にひろがるチャンスと私たちが創るイメージセンサの世界 上田 康弘 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) 代表取締役社長	CPS(Cyber Physical Systems)時代におけるカメラアプリケーション(センシング)市場と課題、そしてソニーイメージセンサーの優位性、今後の展開についてご紹介します。
	11:30 12:15	基調講演  IoT/CPS社会における電子デバイス産業へのチャレンジ 齋藤 昇三 (一社)日本電子デバイス産業協会 代表理事・会長	IoT/CPS社会の実現に向けて議論が活発化している。データを収集し、膨大な量のデータを記憶し、処理することが課題となります。データセンターに集中的に記憶するか、エッジで分散的に処理して記憶するか?これに必要なメモリデバイスとストレージシステムとは?日本の電子デバイス産業の進むべき戦略を議論する。
	13:00 13:45	基調講演  IoT時代にニッポンの製造業が一気に抜け出す!! ~そのカギは日本のお家芸のセンサーとロボットだ! 泉谷 涉 (株)産業タイムズ社 代表取締役社長	IoTの波が世界で巻き起こっている。すべてのモノをネットをつなぎ、新たな社会インフラを作る技術革新が進展していく。IoTでは45兆個ものセンサーが必要となるが、この分野で世界シェア40%の日本企業の存在感は増していく。またIoT時代にブレイク確実なロボットも日本のお家芸であり、大型設備投資も計画されている。
14:00 15:30	特別パネルディスカッション (CIPA協力) 4K/8K用入力機器としてのデジタルカメラ		
6月3日(金)	10:30 11:15	基調講演  環境対応車両に向けたパワーエレクトロニクスへの取り組み 戸田 敬二 トヨタ自動車(株) パワーエレクトロニクス開発部 主幹	環境問題に対応して、HV、PHV、FCV、EVと言った車両の開発を行っている。これらの車は、すべて電動のパワートレインを持ち、パワーエレクトロニクスがキーテクノロジーとなっている。その中でもSiに替わるパワー半導体として、SiCデバイスに期待し、早期実用化に向け取り組んでいる。
	11:30 12:15	基調講演  ICTの潮流 ~本格化するIoT/Big Data/AIの動向~ 佐相 秀幸 (株)富士通研究所 代表取締役会長	ICTの最新トレンドであるIoT、Big Data、AIの更なる進展に向けて、フロントのデバイス・センサーの小型化・省電力化やコンピューター性能の向上が求められています。そのための実装技術も更に重要度を増しています。本講演では、ICTの潮流を紹介すると共にそれを支える実装技術への期待を述べたいと思います。
	13:00 13:45	基調講演  暮らしと社会を支える家電 技術動向と将来展望 今井 淨 パナソニック(株)アプライアンス社 副社長	パナソニック(株)アプライアンス社は、家庭生活や社会生活を支える電気製品を幅広く展開している。アプライアンス社では、お客様の価値感の変化や社会環境の変化に対応すべく、新しい家電づくりの挑戦や技術イノベーションの取組みを進めており、本講演では、その事例を通してこれからの家電の開発の視点を紹介する。
14:00 14:45	基調講演  脳IoTセンサーの実現を目指した新技術開発と将来展望 関谷 毅 大阪大学 産業科学研究所 教授	IoTの社会背景を概観し、最新の「センサ技術」、「情報処理技術」、「通信技術」、「材料技術」の融合研究による新しいフレキシブルIoTセンサ(特に脳をインターネットにつなぐシート型脳波センサ)の形を紹介したい。さらにそれを使いこなす「サイバー空間におけるアルゴリズム」との融合展開について紹介する予定である。	

5. JIEP 最先端実装技術シンポジウム 有料 6H-JIEP A会場・B会場

●聴講者数：622名（前回実績：549名）

		6H-JIEP A会場		6H-JIEP B会場	
6月1日(水)		1A1 部品内蔵からモジュラーエレクトロニクスへ 座長：土門 孝彰	1B1 新世代の医療・ヘルスケアを切り拓く最先端技術 座長：越地 福朗		
	10:40 11:35	変化の著しいエレクトロニクス製品・デバイスの内側を探る —インサイド アナリシス ベンチマーケー— 保坂 透 チップワークス(株) セールス リージョナルセールスディレクター 	体内埋込型医療機器へのワイヤレスエネルギー伝送・情報伝送 柴 建次 東京理科大学 基礎工学部電子応用工学科 准教授 		
	11:35 12:30	最新モジュラー・エレクトロニクス —市場性と技術開発動向— 宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株) 代表取締役 	高信頼無線BANによるウェアラブルセンシング技術の発展 杉本 千佳 横浜国立大学 未来情報通信医療社会基盤センター 准教授 		
		1A2 導電性接合材料の進化を支える新技術 座長：小日向 茂	1B2 予防から治療へ「ヘルスケア技術の最前線」 座長：近藤 雄		
	13:35 14:30	銅微粒子の耐酸化性付与、ペースト作製と低温焼結 米澤 徹 北海道大学 工学研究院 教授 	内視鏡による早期診断・低侵襲治療 後野 和弘 オリジナル(株) 医療技術開発部 部長 		
	14:30 15:25	接着の分子論 吉澤 一成 九州大学 先端物質化学研究所 教授 	キャピタス(体腔)センサと探嗅カメラによる 日常医療(未病・予防)への取り組み 三林 浩二 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授(副理事) 		
15:25 16:20	20Gbps超の高速信号伝送に対する新しい可能性 大塚 寛治 明星大学 連係研究センター 名誉教授、特別顧問、主幹研究員 	「未病器」という考え方・・・ 新藤 幹雄 (株)ニタ 事業戦略本部 企画開発部 執行役員 部長 			
6月2日(木)		2A1 自動運転に向けた車載システムの動向と実装技術 座長：三宅 敏広	2B1 最先端の光インターコネクション技術と今後の展望 座長：松原 孝宏		
	9:45 10:40	自動運転実現に向けたカーエレクトロニクス技術 広津 鉄平 株式会社製作所 研究開発グループ グリーンモビリティ研究部 ユニットリーダー主任研究員 	スーパーコンピュータにおける光インターコネクションの現状と展望 安島 雄一郎 富士通(株) 次世代テクニカルコンピューティング開発本部 シニアアーキテクト 		
	10:40 11:35	高速イメージセンサ通信の路車間・車車間通信への応用 山里 敬也 名古屋大学 教養教育院 教授 	ポリマー光導波路の開発概況と今後の展望 尾張 洋史 住友ベークライト(株) COIN開発部 主任研究員 		
	11:35 12:30	車載システムにおけるセンシングと実装技術 前田 幸宏 (株)デンソー 半導体実装開発部第2開発室 室長 	光インターコネクションに向けた集積フォトニクス技術 堀川 剛 技術研究組合光電子融合基盤技術研究所(PETRA) / 産業技術総合研究所(AIST) つくば研究開発センター 主幹研究員 		
		2A2 次世代パワーデバイスの現状と今後の展望 座長：渡邊 裕彦	2B2 プリンタブルデバイスとマイクロ接合技術 座長：本多 進		
	13:35 14:30	高密度電力変換システムのための 次世代パワーモジュールテクノロジー 谷本 智 (株)日産アーク デバイス機能解析部パワーエレクトロニクス解析室 副部長 	表面活性化接合(SAB)技術の量産装置への適用 山内 朗 ボンドテック(株) 代表取締役 		
14:30 15:25	次世代パワーデバイスの本格量産に向けて 乗り越えなければならない障壁 山本 秀和 千葉工業大学 工学部 教授 	多様化する実装要求を実現する 世界初「低温・低荷重」ダメージフリー・フリップチップ接合技術 平田 勝則 コネクテックジャパン(株) 代表取締役 			
15:25 16:20	新材料パワー半導体デバイス(SiC/GaN/酸化ガリウム)の最新動向 岩室 憲幸 筑波大学 数理工学系 教授 	高密度実装実現に向けたはんだ材料からのアプローチ 高斎 光弘 千住金属工業(株) ハンダテクニカルセンター 上級研究員 			
6月3日(金)		3A1 エネルギー、バイオ、ロボット、MEMSが切り開く新局面 座長：内木場 文男	3B1 電子デバイス実装(IoT、センサ、メモリ) 座長：本多 進		
	9:45 10:40	IoT用途を目指したMEMS振動発電素子 年吉 洋 東京大学 先端科学技術研究センター 教授 	急拡大が見込まれるトリリオンセンサの動向 寺崎 正 産業技術総合研究所 製造技術研究部門トリリオンセンサ研究グループ 研究グループ長 		
	10:40 11:35	プラズマとマイクロバブルによるバイオメディカル応用 山西 陽子 九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門 教授 	IoT、M2Mに向けたなんでもつなぐダイレクト接合技術 八甫谷 明彦 (株)東芝 セミコンダクター&ストレージ社 主幹 		
	11:35 12:30	生物を模倣した技術を実装した昆虫型マイクロロボット 齊藤 健 日本大学 理工学部 精密機械工学科 助教 	ナノ液体プロセスによるデバイス開発 下田 達也 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科 教授 		
		3A2 次世代モバイル機器対応実装技術 座長：和嶋 元世	3B2 3D実装・モジュール 座長：西田 秀行		
	13:35 14:30	次世代モバイル機器対応高密度有機インターポーザ 福岡 義孝 ウェイスティー 代表 	Fan Out WLP Technology as 2, 3D System in Packaging(SiP) Solution English Lewis Kang NEPES 		
14:30 15:25	低反りを実現する新規ICパッケージ用ビルドアップ材料 白波瀬 和孝 積水化学工業(株) 高機能プラスチックカンパニー 新事業推進部 IMプロジェクト プロジェクトヘッド 	先端機器における3DおよびModuleの進化 加藤 凡典 (有)イー・アイ・ティ 代表取締役 			
15:25 16:20	半導体プロセスを応用した次世代高信頼性微細配線技術 神吉 剛司 (株)富士通研究所 R&D 戦略本部 マネージャー 	3D-MIDの市場動向とLPKF-LDS® 工法の紹介 上館 寛之 LPKF Laser&Electronics(株) テクニカルセールスエンジニア 			



6. 出展者セミナー

1) NPIプレゼンテーション (出展者製品技術セミナー)

- 日時：6月1日(水)～3日(金)
- 会場：2H-NPI会場I・5H-NPI会場II
- 聴講料：無料
- 聴講者数：1,892名(前回実績：1,408名)

●発表出展会社 (50音順)
 アトテックジャパン(株)/アユミ工業(株)/荒川化学工業(株)/(株)石井表記/
 伊藤忠マシンテクノス(株)/インスペック(株)/上村工業(株)/ウシオ電機(株)/
 LPKF Laser & Electronics/(株)オーク製作所/沖縄県/奥野製薬工業(株)/
 ガーディアンジャパン(株)/キヤノントッキ(株)/KOA(株)/(株)ケミトックス/
 (株)サーマプレジジョン/(株)サクラクレバス/山陽精工(株)/(株)JCU/(株)島津製作所/
 ジョージフィッシャー(株)/シライ電子工業(株)/
 (株)SCREEN グラフィックアンドプレジジョンソリューションズ/(株)セリアコーポレーション/
 千住金属工業(株)/ダイナトロン(株)/テクノアルファ(株)/(株)デンソー/NovaCentrix/
 (株)ニソール/日本オルボテック(株)/日本化学産業(株)/パナソニック(株)/(株)ピーバンドットコム/
 日立化成(株)/日立金属(株)/(株)日立ハイテクサイエンス/
 (公財)福岡県産業・科学技術振興財団/富士通インターコネクトテクノロジーズ(株)/
 メルテックス(株)/(株)安永/ユニオンツール(株)/利昌工業(株)/(株)ロロムジャパン

2) 3D-MIDセミナー

- 日時：6月1日(水)～3日(金)
- 会場：3H-3D-MIDパビリオン
- 聴講料：無料
- 聴講者数：473名(前回実績：474名)

●発表出展会社 (50音順)
 (地独)岩手県工業技術センター/LPKF Laser & Electronics(株)/
 エンジンガージャパン(株)/奥野製薬工業(株)/三共化成(株)/(株)図研/
 大英エレクトロニクス(株)/日本MID協会/日本マクダーミッド(株)/日本モレックス(同)

3) PROTECセミナー

- 日時：6月1日(水)～3日(金)
- 会場：5H-PROTEC会場
- 聴講料：無料
- 聴講者数：700名(前回実績：881名)

JISSO PROTEC 特別講演

6月2日(木) 14:00 - 15:00

自動運転～車とITとAIの融合～

東京大学 大学院情報理工学系研究科 准教授 加藤 真平

6月3日(金) 14:00 - 15:00

2015年度版 JEITA 実装技術ロードマップより実装設備の概要と今後の展開

パナソニック ファクトリーソリューションズ(株) 技術品質課・主任技師 及び
JEITA Jisso 技術ロードマップ専門委員会 WG6 主査 井上 高宏

●発表出展会社 (50音順)
 パナソニック(株)/パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)/富士機械製造(株)/
 武蔵エンジニアリング(株)/ヤマハ発動機(株)

4) アカデミックプラザ

- 日時：6月1日(水)～3日(金)
- 会場：6H-アカデミックプラザ
- 聴講料：無料
- 聴講者数：540名(前回実績：464名)

●アカデミックプラザ参加大学・研究機関等一覧 (50音順)
 大阪府立大学/沖エンジニアリング(株)/関東学院大学/九州大学/
 群馬工業高等専門学校/群馬大学/神戸大学/信州大学/電気通信大学/東京工芸大学/
 (地独)東京都立産業技術研究センター/同志社大学/長野県工業技術総合センター/
 長野工業高等専門学校/日本大学大学院/フォトテクニカ(株)/ミドリ電子(株)/
 山口東京理科大学/早稲田大学

5) 2016 アカデミックプラザ受賞式

アカデミックプラザで発表される研究発表論文の中から、JIEP展示会事業委員会(小岩委員長：関東学院大学 理工学部 化学学系 教授)で優秀な論文内容が選考され、アカデミックプラザ賞受賞者が決定致しました。

■マイクロエンコーダを用いた速度センサと各種超小型センサ

九州大学大学院機械航空工学科 中島 文弥
九州大学大学院システム生命科学府 森田 伸友
東京大学工学系研究科 日暮 栄治
九州大学工学研究院 野上 大史、澤田 廉士

■高位合成ツールを使った軽量ブロック暗号規格の性能評価

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター 開発第一部 情報技術グループ 岡部 忠

■回路素子を範囲で与えるフィルタ設計

電気通信大学大学院 情報理工学系研究科 川上 雅士、石川 晴雄、肖 鳳超
電気通信大学 研究推進機構 産学連携センター 上 芳夫

— 選好度付きセットベース設計(PSD)手法の応用

アカデミックプラザ5年連続継続賞

東京工芸大学 越地研究室



7. 標準化セミナー / 電子機器分解セミナー / 「夢をカタチに」セミナー

● 標準化セミナー **無料**

6H-JPCA 標準化セミナー会場

● 聴講者数：プリント配線板技術ロードマップ 433名 (前回実績：506名)
 PWBコンサルタント活動 103名 (前回実績：22名)
 統合規格 235名

6月1日(水)	プリント配線板技術ロードマップ		
	10:30-11:30	プリント配線板技術ロードマップ～最新トピックス～	宇都宮 久修 インターコネクション・テクノロジーズ(株)
	PWBコンサルタント活動		
	11:30-12:30	コンサルタントからの提言1 品質向上に求められる基板設計!	嶋田 茂晴 シイエムケイ・プロダクツ(株)
	統合規格		
6月2日(木)	12:30-13:30	高輝度LED用電子回路基板規格・測定方法の国際標準化及び今後の展開	米村 直己 デンカ(株) 主幹研究員
	13:30-14:30	部品実装品質基準制定で統合規格を充実!電子回路基板規格(UBO1)第2版の紹介	浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会
	14:30-15:30	部品内蔵基板技術の国際標準化活動(FUJIKO他)	松澤 浩彦 (株)図研
	プリント配線板技術ロードマップ		
	10:30-11:30	プリント配線板技術ロードマップ～最新トピックス～	角井 和久 富士通コネクテッドテクノロジーズ(株)
6月3日(金)	PWBコンサルタント活動		
	11:30-12:30	コンサルタントからの提言2 料金設定の大切さ	榎場 正男 (株)カヤバオフィス 代表取締役
	統合規格		
	13:30-14:30	部品実装品質基準制定で統合規格を充実!電子回路基板規格(UBO1)第2版の紹介	浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会
	14:30-15:30	電子回路基板の放熱特性評価他の動向	住田 智希 (株)ケミックス アソシエートエンジニア
6月3日(金)	プリント配線板技術ロードマップ		
	10:30-11:30	プリント配線板技術ロードマップ～最新トピックス～	上原 利久 京セラ(株)
	PWBコンサルタント活動		
	11:30-12:30	コンサルタントからの提言3 デザインレビューの大切さ	長谷川 堅一 PWBコンサルタント
	統合規格		
12:30-13:30	熱抵抗測定ガイドラインとシーマ電子受託試験組立サービスについて	東条 三秋 シーマ電子(株)	
13:30-14:30	部品実装品質基準制定で統合規格を充実!電子回路基板規格(UBO1)第2版の紹介	浦西 泰弘 JPCA 統合規格部会	
14:30-15:30	「フラッシュ金めっき」規格の数値化へ(目視から数値管理)	榎場 正男 / 野中 一洋 / 斉藤 和正 / 八甫谷 明彦 (株)カヤバオフィス / 産業技術総合研究所 / (有)実装彩科 / (株)東芝	

● 電子機器分解セミナー **無料**

● 聴講者数：1,595名 (前回実績：1,412名)

2H-電子機器分解セミナー会場

会期3日間共通	10:30-10:50	Apple 社 iPhone 6S、6S Plus に見る実装と関連部品の動向	上田 弘孝(セミコンサルト) ※3日間共通
	11:30-11:50	Apple 社 iPad Pro に見る実装と関連部品の動向	
	12:30-12:50	iPad の競合品 Microsoft 社 Surface Pro4 に見る実装と関連部品の動向	
	13:30-13:50	Samsung Galaxy S7 edge に見る実装とAMOLED の技術動向	
	14:30-14:50	携帯電子機器の感圧センサの技術動向	
	15:30-15:50	スマートフォンの半導体パッケージング技術の動向	
	16:30-16:50	市場拡大が続くカメラモジュール技術の動向	

● 「夢をカタチに」セミナー **無料**

● 聴講者数：348名 (前回実績：293名)

6H-夢をカタチにパビリオン

6月1日(水)	13:00-13:20	ドローンのマーケット動向	壺 秀樹 (株)産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 編集委員
	13:30-13:50	基礎知識:ドローンの仕組みと種類	稲田 悠樹 ドローン情報サイト「DRATION」代表
	14:00-14:50	実用知識:IoT時代のドローン活用術	稲田 悠樹 ドローン情報サイト「DRATION」代表
6月2日(木)	15:00-16:30	電子部品・モーター&モジュール設計の基礎知識 ～スマホには1000個以上の電子部品が使われている!～	加藤 一 (株)産業タイムズ社 事業開発部 特別顧問
	12:30-12:50	IoT時代のロボット産業の動向	壺 秀樹 (株)産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 編集委員
	13:00-13:50	航空機産業の動向と市場参入	山下 寛己 (株)エス・エム・エル 代表
	14:00-14:50	人工知能とロボットが描く未来	斎藤 匠 Rappa(株) 代表取締役社長
	15:00-16:00	ミニマルフォトリソ工程とMOCVDのハイブリッドプロセスを使った窒化ガリウム系青色LED作製	岩田 真典 (株)ピーエムティー 半導体技術・製品企画顧問
6月3日(金)	13:00-13:50	プリント基板修理の近代化	山下 寛己 三協電精(株) 代表取締役
	14:00-14:50	電子デバイス実装技術入門 ―電子デバイス実装技術の初歩や最新動向を分かりやすく解説―	沢谷 博道 福電資材(株) 技術顧問
	15:00-15:50	大丈夫?韓国半導体産業	巖 在漢 (株)産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 ソウル支局長
	16:00-17:00	プリント配線板のマーケット動向	野村 和広 (株)産業タイムズ社 電子デバイス産業新聞 副編集長



8.主催者セミナー 無料

2H・5H-主催者セミナー会場I・II

●聴講者数：

ぶりんとばんじゅくセミナー 278名(前回実績：246名)
 JPCA設計セミナー 287名(前回実績：90名)
 JPCAめっき表面処理セミナー 333名(前回実績：247名)

環境安全セミナー 6名(前回実績：48名)
 ダントツものづくりセミナー 962名
 光電子回路実装標準化推進委員会セミナー 223名(前回実績：413名)

2H-主催者セミナー会場I

6月1日(水)	ぶりんとばんじゅくセミナー	
	10:30-12:00	ぶりんと配線板全般について「ぶりんとばんじゅくI」をもとに基礎から解決 小林 正 小林技術事務所
	13:00-14:30	ぶりんと配線板設計について「ぶりんとばんじゅくII」をもとに基礎から解決 田中 弘文 (株)オンテック
	15:00-16:30	物作りの競合力を強める品質管理 長谷川 堅一 PWBコンサルタント
6月2日(木)	ぶりんとばんじゅくセミナー	
	10:30-12:00	ぶりんと配線板全般について「ぶりんとばんじゅくI」をもとに基礎から解決 小林 正 小林技術事務所
	JPCA設計セミナー	
	13:00-14:30	電源/GNDの影響を考慮したDDR4の設計検証と実測との比較 梅川 光晴 キーサイト・テクノロジー(同) EDAアプリケーションエンジニア
	14:40-16:10	DDR4をターゲットにしたJPCAが進めるPCB設計製造ガイドライン 須藤 俊夫 芝浦工業大学 名誉教授/益子 行雄 (一社)日本電子回路工業会 理事
6月3日(金)	ぶりんとばんじゅくセミナー	
	10:30-12:00	ぶりんとばんじゅくVをもとに、半導体のパッケージング、電子部品などの電子回路実装について解説 榎場 正男 (株)カヤバオフィス/PWBコンサルタント
	JPCAめっき表面処理セミナー	
	13:00-14:00	フィールドめっきについて 亀川 正樹 (株)アズマ
	14:00-15:00	ファインピッチ化へのめっき対応 奥富 弘樹 栄電子工業(株)
	15:00-16:00	めっき工場における改善活動 工藤 淳司 ブラメックス(株)

5H-主催者セミナー会場II

6月1日(水)	JPCA設計セミナー	
	11:00-12:00	バリューを紡ぐ。設計エコシステムを生み出すしくみ～規格がそのつなぎの役目を担う。IEEE2401/IEC dual logo～ 福場 義憲 JEITA EDA技術専門委員会 LSI Package Board (LPB) 相互設計ワーキンググループ 主催
	13:00-14:30	インダストリアルIoTを実現する、ザイリンクスの最新FPGA 神保 直弘 ザイリンクス(株) マーケティング部 シニアマネージャー
	14:40-16:10	DDR4をターゲットにしたJPCAが進めるPCB設計製造ガイドライン 須藤 俊夫 芝浦工業大学 名誉教授 益子 行雄 (一社)日本電子回路工業会 理事
6月2日(木)	環境安全セミナー	
	10:30-12:00	JPCA版危険予知訓練(KYT)用教材の活用について 川村 操 日本メクトロン(株) 業務本部 環境安全部長
	ダントツものづくりセミナー 特別講演	
	13:00-13:50	「グローバル時代の日本のものづくり」 新宅 純二郎 東京大学大学院経済学研究科教授 ものづくり経営研究センター 研究ディレクター
	ダントツものづくりセミナー	
	13:50-14:20	ダントツプロジェクト「JPCAに於ける生産性向上活動」総括 山本 治彦 (一社)日本電子回路工業会 副会長 超高効率電子回路生産システム(E-ESMAP)研究会 代表幹事
	14:30-15:10	生産性向上プロセス改善「レジストインク層硬化時間を1/10に」 村上 英治 (株)村上電子工学 代表取締役社長/長谷川 俊介 ケセル(株) 代表取締役社長
15:10-15:50	「作業効率の改善を可能にする、低コストスーパークリーン空間形成技術の紹介」 石井 敬史 興研(株) 東京営業所 所長	
15:50-16:30	「改善ネタが溢れだす次世代見える化で生産性30%UP!」 西村 威彦 (株)富士通システムズ・イースト ビジネス戦略本部新規ビジネスソリューション統括部新規ビジネス推進部	
6月3日(金)	光電子回路実装標準化推進委員会セミナー	
	10:30-10:40	委員長あいさつ 中野 義昭 東京大学 工学系研究科 教授
	10:40-11:00	光電子回路実装の国際標準化状況 伊藤 日出男 栃木県産業技術センター所長 IEC/TC91/JWG9 Convenor
	11:00-11:40	光インターコネクション用導波路の最近動向 疋田 真 イーラムダネット(株) 担当部長
	11:40-12:30	北米におけるデータセンタ周辺の光化状況 佐武 俊明 US Conec Ltd Chief Scientist
6月3日(金)	ダントツものづくりセミナー 特別講演	
	13:00-13:50	「トヨタ式カイゼンの会計学」～人を減らすな!在庫を減らせ!～時間を切り口にもものづくりを評価する～ 田中 正知 ものづくり大学名誉教授/元トヨタ生産調査部部長 (株)Jコスト研究所 代表取締役
	ダントツものづくりセミナー	
	13:50-14:20	ダントツプロジェクト「JPCAに於ける生産性向上活動」総括 山本 治彦 (一社)日本電子回路工業会 副会長/超高効率電子回路生産システム(E-ESMAP)研究会 代表幹事
	14:30-15:10	生産性向上に向けた電子回路業界へのロボット導入 長谷川 省吾 川崎重工業(株) 精密機械カンパニー ロボットビジネスセンター FA・クリーン総括部 総括部長
	15:10-15:50	電子回路基板製造のIT活用による生産効率向上とその進化 尾崎 陽介 (株)オーケープリント 代表取締役社長
	15:50-16:00	まとめ 山本 治彦 (一社)日本電子回路工業会 副会長/超高効率電子回路生産システム(E-ESMAP)研究会 代表幹事

9.共催/特別協力セミナー/実装体験コーナ/産業技術総合研究所・特別展示

● 共催/特別協力セミナー **無料**

6H-共催/特別協力セミナー会場

6月1日(水)	TPCAセミナー ●聴講者数：92名	
	10:30-11:30	The Latest Profile of PCB and Packaging Industries in Taiwan and China 中国語/逐次通訳 Mr. Jeremy Tung Industrial Technology Research Institute Senior Researcher
	11:30-12:30	Fine bump pitch and embedded substrate overview 中国語/逐次通訳 Ms. Hsiu-Mei Yu Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd. Senior Manager of Special Turnkey Program
6月2日(木)	半導体・オブ・ザ・イヤー2016 ●聴講者数：87名(前回実績：65名)	
	14:00-15:00	半導体・オブ・ザ・イヤー2016 受賞製品・技術発表
	15:00-17:00	受賞各社による製品プレゼンテーション
6月3日(金)	WIRE Japan Showセミナー ●聴講者数：38名(前回実績：107名)	
	10:30-11:10	これからの難燃材料・難燃技術にもとめられるもの 大越 雅之 京都工芸繊維大学伝統みらい教育センター
	11:10-11:50	電線・部材の燃焼試験概要と国際規格の動向 山崎 庸介 電線総合技術センター 燃焼技術グループ主管
6月3日(金)	「国際競争を後押しする制度、仕組み、活用事例」知財、標準化とリスク対応セミナー ●聴講者数：157名	
	11:50-12:30	難燃材料研究会の取り組み 大越 雅之 京都工芸繊維大学伝統みらい教育センター
	12:50-13:00	開催の主旨/委員長挨拶 井上 博文 日本電気(株) IoTデバイス研究所 シニアエキスパート
	13:00-13:40	経済産業省の委託研究開発における知的財産マネジメントについて 藤河 正英 経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課 成果普及・連携推進室長
	13:45-14:25	「標準化を市場拡大のビジネスツールに」 斉藤 和則 経済産業省 産業技術環境局 基準認証広報室長
	14:30-15:10	NEDOプロジェクトにおける国際標準化への取り組み事例について 服部 英次 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 技術戦略研究センター 標準化・知財ユニット 主査
	15:15-15:55	中小企業でのISOマネジメント活用のポイントとその事例 高橋 義郎 高橋マネジメント研究所 代表/桜美林大学大学院 経営学研究科国際標準化研究領域 特任教授
	16:00-16:40	IEC規格での実装技術標準化事例紹介-先端実装技術国際標準化最前線- 春日 壽夫 標準認証イノベーション技術研究組合 (IS-INOTEK) 技術顧問 (Jisso標準・技術) / IEC TC91WG6国際コンピナ
	自治体セミナー ●聴講者数：13名(前回実績：44名)	
	11:50-12:20	電子デバイスの故障・欠陥解析事例の紹介 阿久津 康久 公益財団法人神奈川科学技術アカデミー 高度計測センター センター長
UL Forum ●聴講者数：44名(前回実績：83名)		
13:00-15:15	①2019年実施の安全規格IEC62368-1の動向 榎場 正男 (株)カヤバオフィス ②A:UL796の現状 B:プリント配線板の性能&信頼性試験の紹介 English A:Crystal Vanderpan B:Irving Lee Underwriters Laboratories	

● 実装体験コーナ **無料** **一部企業無料**

●体験者数：42名(前回実績：19名)

4H-実装体験コーナ

ロボットキットを使った部品実装を体験いただけるコーナを設置。

会期3日間共通	11:00-12:30	オルゴールごま コマを回すとその遠心力により電源スイッチが入り4色の発光ダイオードが点灯! 加え、メロディICの音が流れます。 費用 一般:1,000円 出展企業/JPCA会員企業:無料	光センサー・おちないロボ 2つのセンサーで床を探りながら走行するロボット! 落ちそうになっても光センサーがすばやく反応してバックし、方向転換する賢いロボットです。 費用 2,000円
	14:00-15:30		

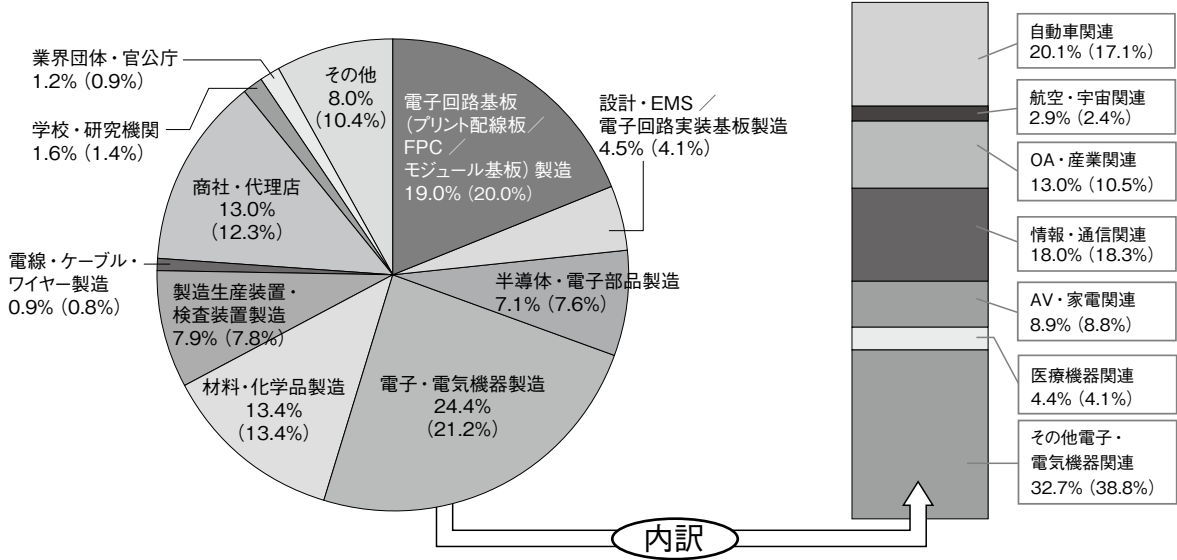
● 産業技術総合研究所・特別展示 会期3日間

東6ホール 6D-16

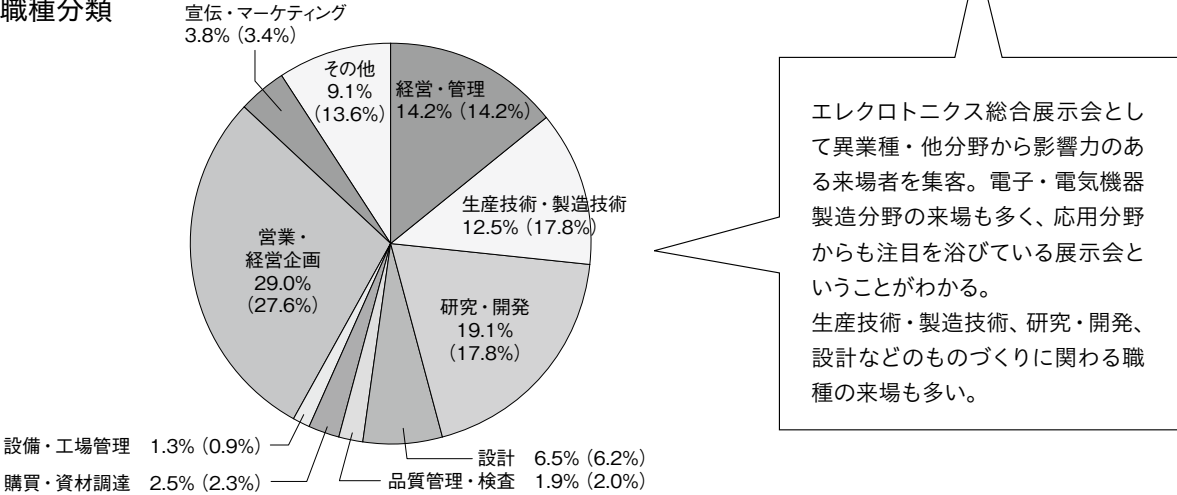
産業技術総合研究所の共用施設の紹介	TIA 推進センター 浅沼 周太郎、有本 宏、多田 哲也
L/S=10μm以下の銅/ポリイミド積層配線の作製技術の開発	集積マイクロシステム研究センター ウエハレベル実装研究チーム 高木 秀樹、尹 成圓、倉島 優一、鈴木 健太
低温プラズマ焼結 (GPS) とその応用試作品	フレキシブルエレクトロニクス研究センター 機能発現プロセスチーム 白川 直樹、所 和彦
鉛フリー圧電センサ技術	電子光技術研究部門 酸化物デバイスグループ 王 瑞平
レーザープロセスによるセラミックスの表面修飾	電子光技術研究部門 超高速フォトニクスグループ 鳥塚 健二、屋代 英彦、欠端 雅之
白色パルス光焼成によるデバイス部材作製	電子光技術研究部門 分子集積デバイスグループ 島田 悟、橋 浩昭、周 英、則包 恭央、阿澄 玲子
エレクトロニクス産業における次世代プロセスプラズマの開発	電子光技術研究部門 先進プラズマプロセスグループ 金 載浩、榊田 創、板垣 宏知、中西 博之

全展示会実績

①来場者の業種分類

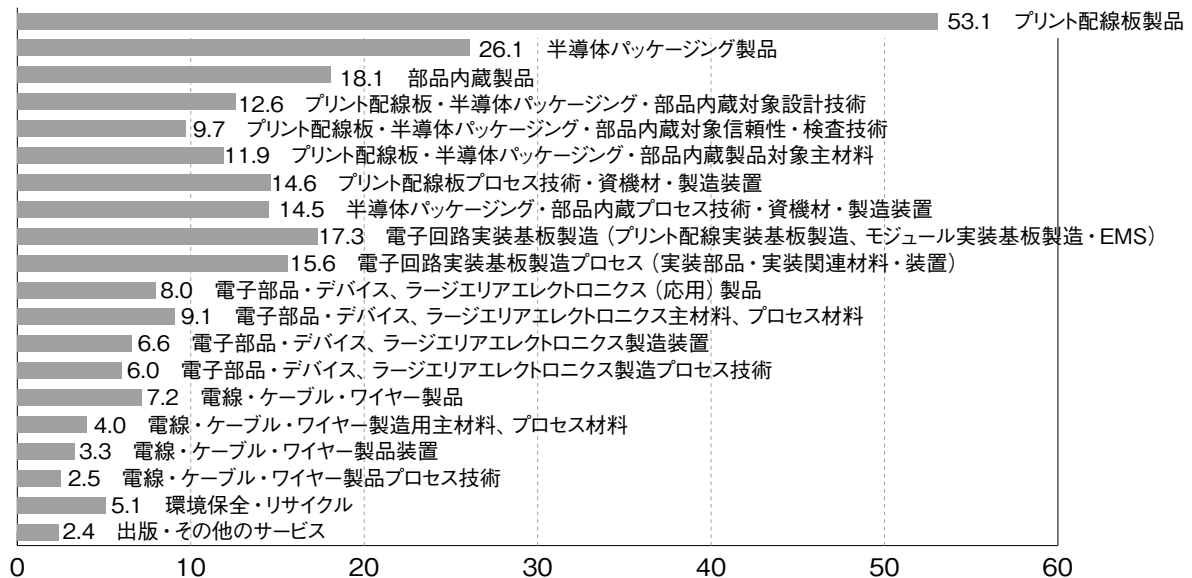


②来場者の職種分類

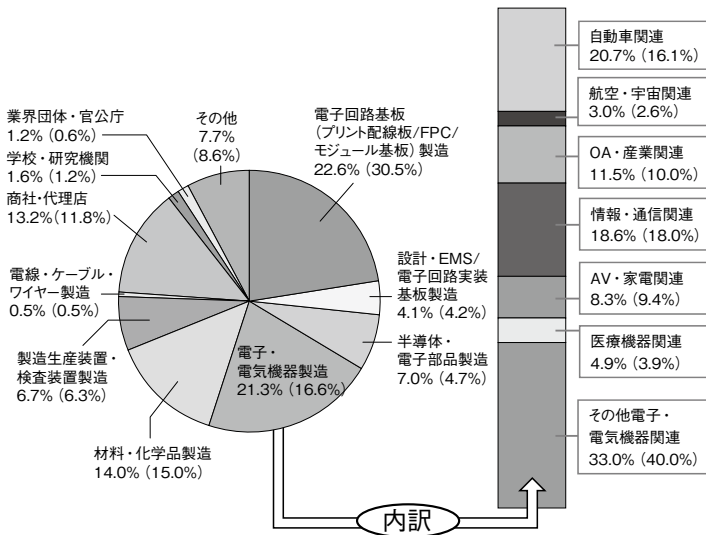


③来場者が関心のある製品分類

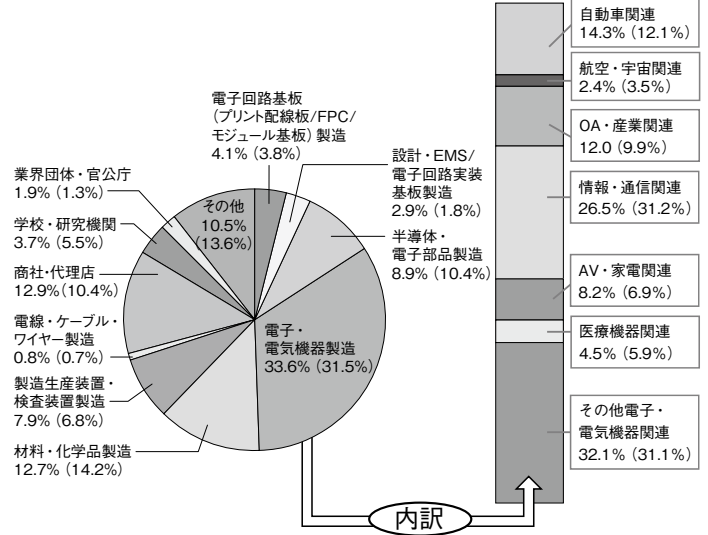
複数回答のため、指数 (ポイント) 表示



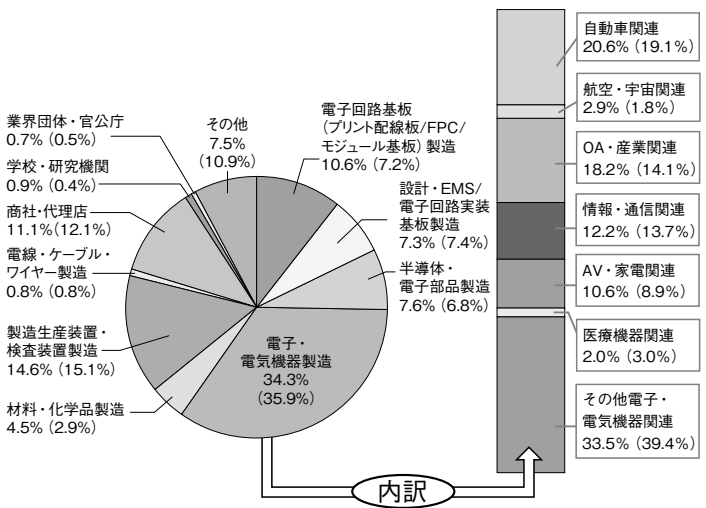
JPCA Show 2016



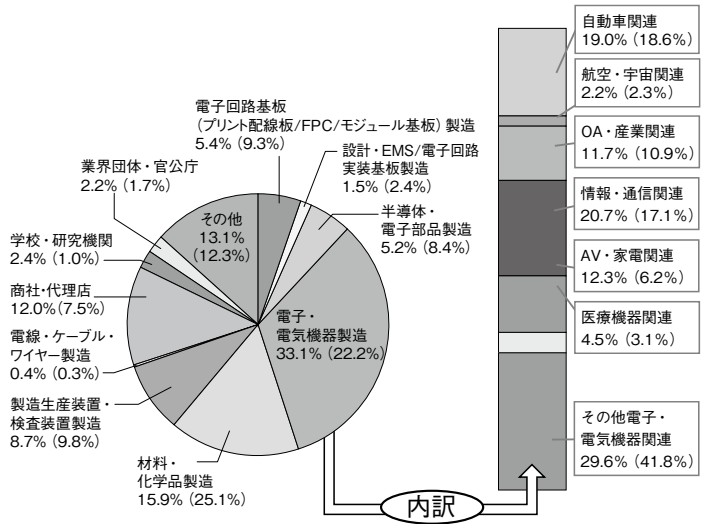
2016マイクロエレクトロニクスショー



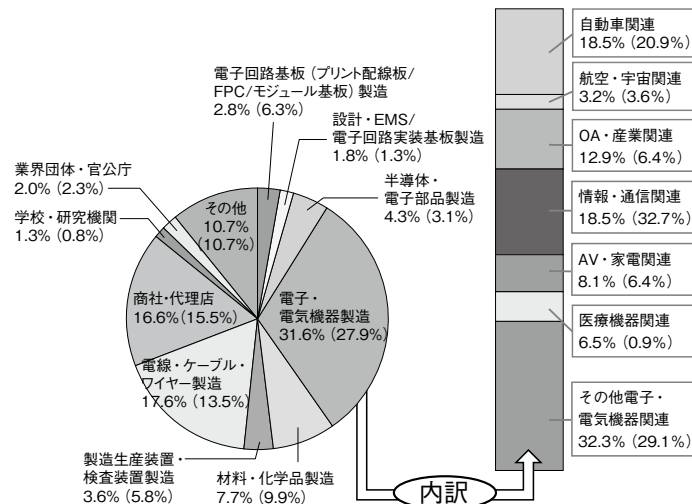
JISSO PROTEC 2016



ラージエレクトロニクスショー2016



WIRE Japan Show 2016



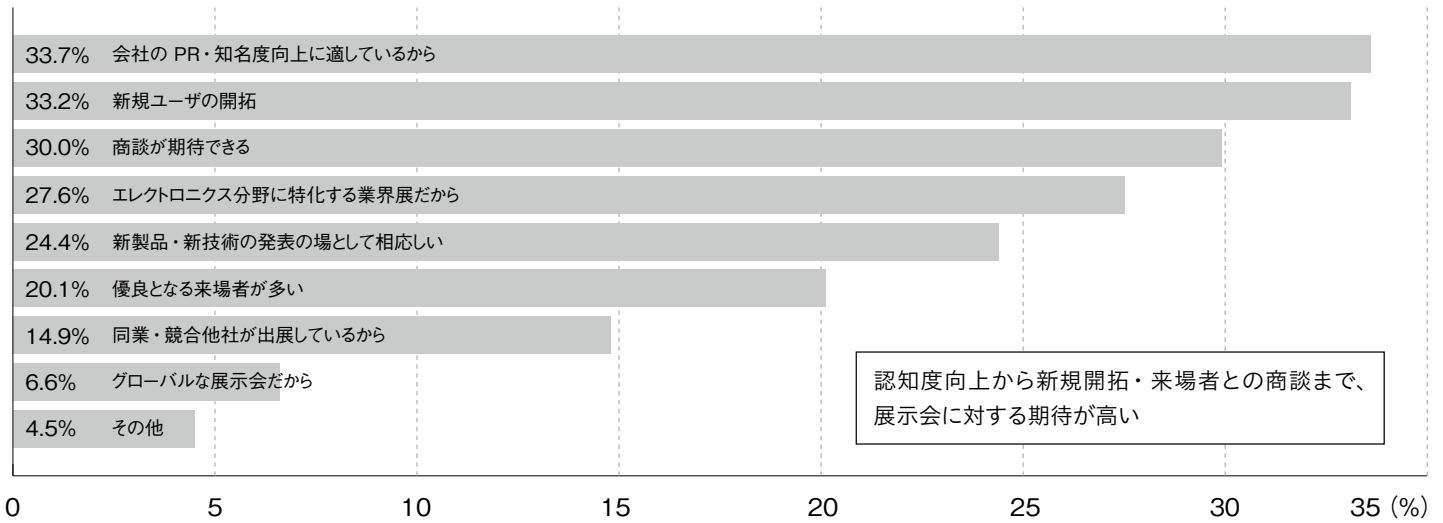


11. 出展者アンケート

※会期中に実施。回答者 377 名を対象

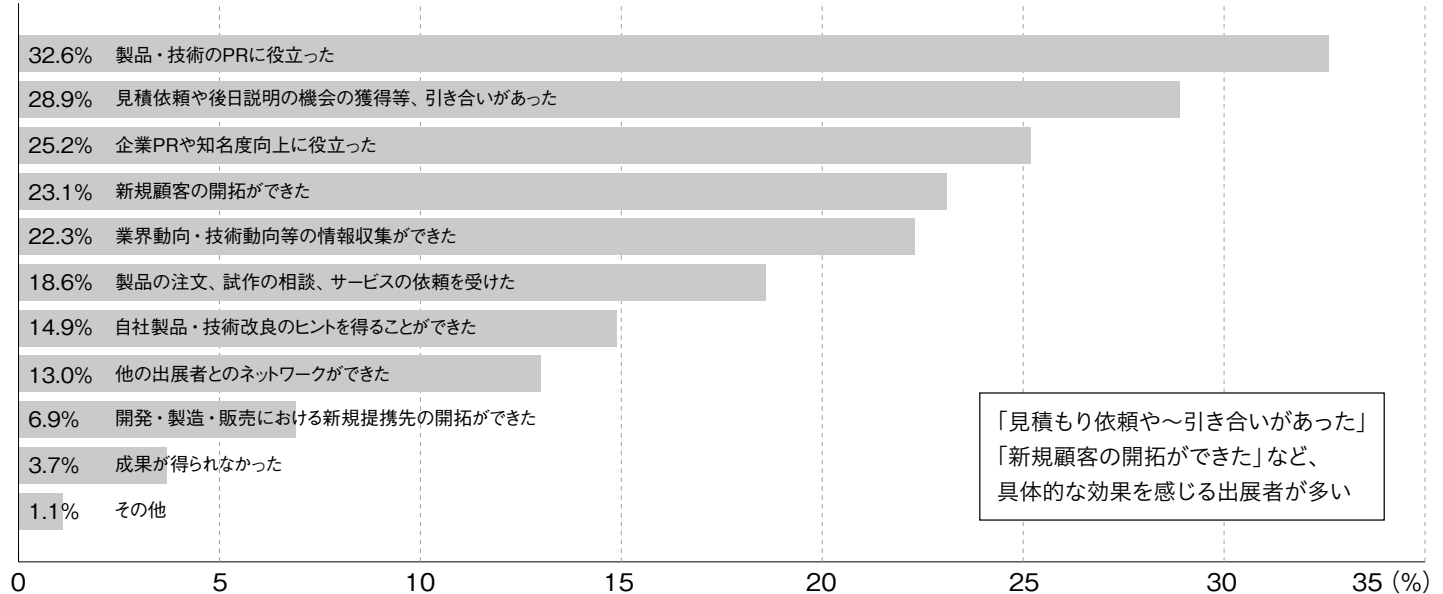
① 出展目的

※複数回答



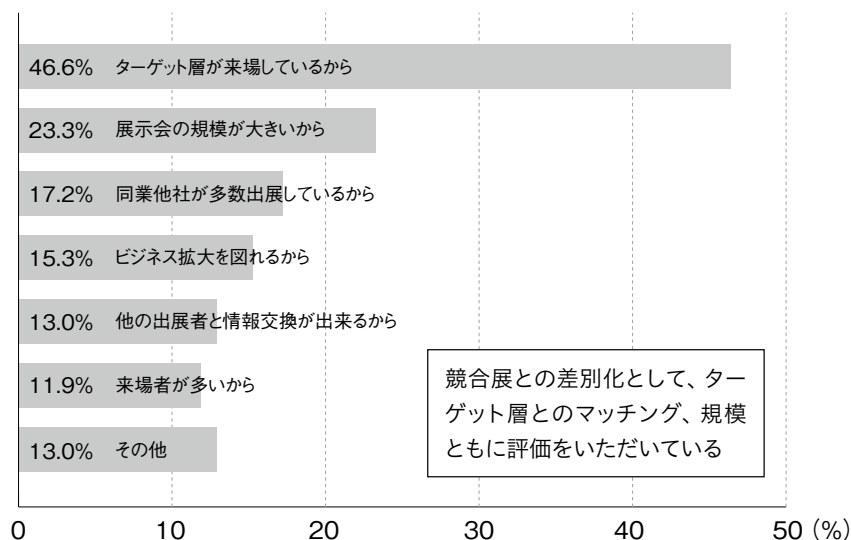
② 出展結果

※複数回答

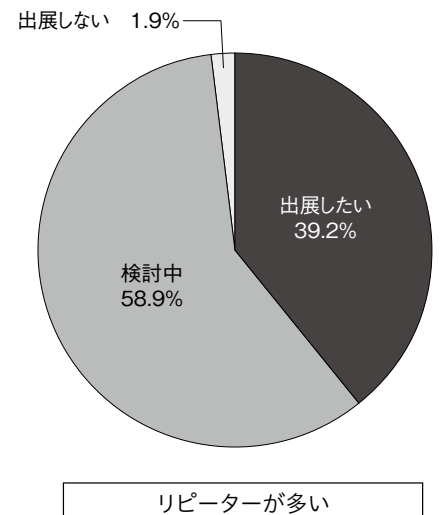


③ 様々なエレクトロニクス展の中から本展を選んだ理由

※複数回答



④ 来年の出展について



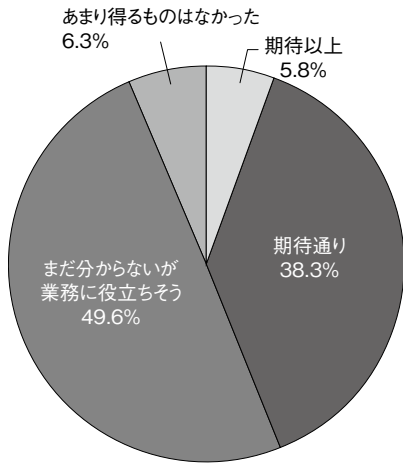


12. 来場者アンケート

※会期後に実施。回答者 605 名を対象

①-1 来場成果

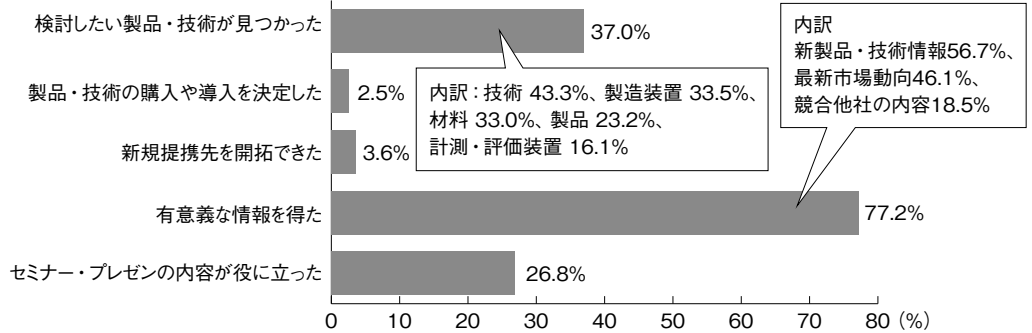
9割以上の方が来場の成果を実感



①-2 具体的な成果

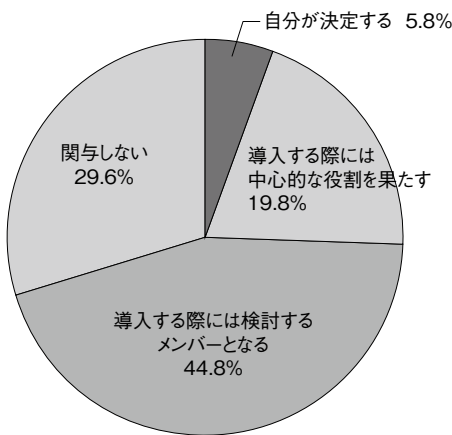
※複数回答

来場者の1/3が展示会会期中に検討製品・技術を発見



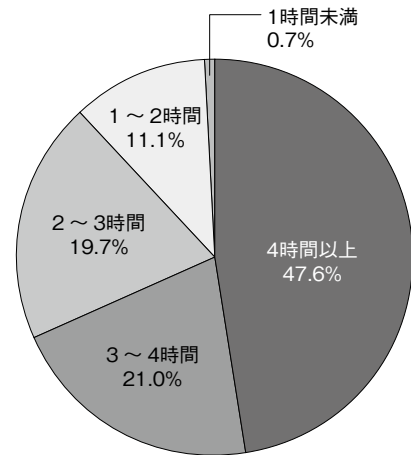
②製品仕込・購入への関与

7割以上が製品技術購入への関与権があり、展示会での商談が期待できる



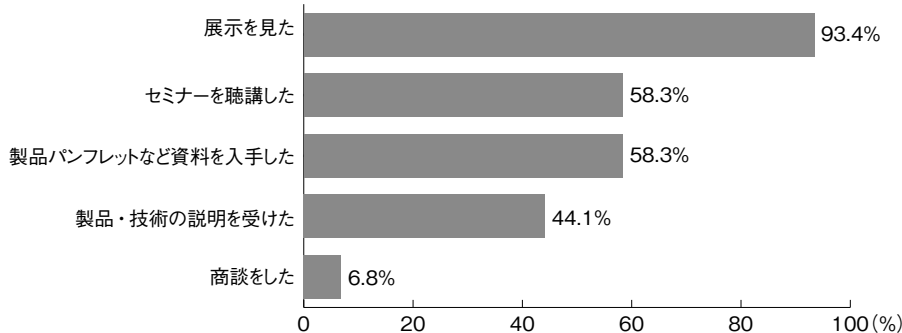
③滞在時間

長時間滞在する傾向にあり、前もって時間を確保する来場者が多く、展示会回遊率が高い



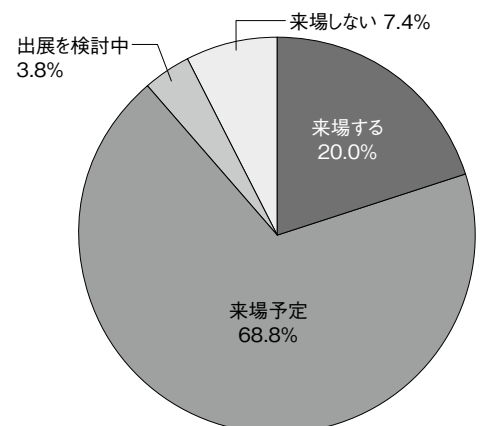
④会場での行動

当日中に商談するのではなく、会場内で出来るだけ多数のブースとコンタクトとり、後日商談につなげる傾向にある



④次回開催の来場予定

9割以上が来場予定



13. ビジネスマッチング

昨年よりビジネスマッチングシステムを導入し、出展運営・商談実施の際のツールとして活用頂いた。

出展者および来場者ともに、展示会を通して登録者のニーズ×シーズを繋げるシステムです。



- 以下のような課題を解決します!**
- ・製品/技術の導出
 - ・製品/サービスの販売/提案
 - ・共同研究/開発のための事業提携
 - ・研究/開発のためのファイナンス、コンサルティング
 - ・製品/技術の導入
 - ・製品/サービスの購入/検討

- ・トライアル期間 5月～会期まで1ヶ月間実施
- ・マッチング件数 情報登録者 121件
来場者お申込者 79件、うち情報登録者 31件
- ・アポイント成立件数 8件

<アポイント例>

- 分析・計測機器メーカー (来場者) × 精密機器・産業機械メーカー (出展者)
- 半導体・電子部品メーカー (来場者) × 大学研究機関 (出展者)
- 精密機器・産業機械メーカー (出展者) × 半導体・電子部品メーカー (出展者)

展示会・業種関係なしに
ニーズシーズを繋ぎ、商談が実現しました!

14. 出展者サービス

●記名印字済みバーコード付出展者バッジ

本年は、記名印字済みのバーコード付出展者バッジ・バーコード無しの従来型出展者バッジの2種類を用意。名刺交換の手間を省くバーコード付出展者バッジは、多数の出展者にご利用頂いた。

●出展者 (NPI) プレゼンテーション

来場者に向けた自社製品・技術をPRする場として、展示会場ホール内にクロード会場をご用意した。プレゼンテーションに必要なPC、プロジェクタ、スクリーン等の備品も無料でご提供し、プロモーションの場として多数の出展者にご活用いただいた。



●多目的ルーム・ストックルーム

出展者の便宜を図るため、専用の多目的ルーム・ストックルームを有料にて貸し出した。専用ストックルームをブース近くに設置することにより、会期中、資材や荷物を安心して保管いただいた。

●ブースで利用可能なPOP印刷用データ

来場者が立ち寄りやすいよう、用途に応じて利用できる各種アイコンデータをご用意。出展者が提供するシーズや提供内容を、来場者へわかりやすくPRした。

- ・機能別展示区分アイコン
> アプリケーションサイド設計担当者が直面する、解決したい課題に対応できる機能別に区分
- ・用途別アイコン
> 出展者の製品・技術を活用できる主な用途に区分
- ・ダントツ生産性向上PRアイコン
> 材料・設備・装置の出展者で、従来より生産性30% UPをアピール
- ・展示会各ブース多言語対応卓上POP
> 海外来場者向けに、出展者の対応可能言語を一目で確認

機能別対策区分表示



用途別アピール



ダントツ生産性アピール



15. 来場者サービス

●VIPラウンジ

「出展者の顧客招待活動の支援」、「来場者サービス向上の一環」、「決定権者の誘致」等を目的として実施された「VIPラウンジ」を展示会場内に4カ所設置。ソフトドリンクなどの飲料や、菓子類のサービスなどを行った。



●インターネット・サービス

来場者への利便性を図るために、各ホール入口、VIPルーム、プレスルーム等会場内で「無料インターネット・サービス」を行った。



●電子回路サプライチェーンiCON展示

電子回路基板及び電子回路実装基板の企画から客先への納品までのビジネスフローに基づき、電子回路全体の製造サプライチェーンを図示し、サプライチェーン上に連なる出展者(希望者)の社名ロゴマーク及び小間番号を表示した巨大ボードをホール内に設置した。



16. スポンサーシップ

一昨年から導入したスポンサーシップに、昨年からプラチナスポンサーを加え、公募実施。約4万人の来場者へ広くアピール頂ける様々なスポンサー特典を用意し、ご活用頂いた。

プラチナスポンサー
日本メクトロン(株)
ゴールドスポンサー
(株)FPCコネクタ / 日本オルボテック(株) / メルテックス(株)
シルバースポンサー
日本マクダーミッド(株) (順不同)



<i>Platinum Sponsor</i>
Mektec 日本メクトロン株式会社
<i>Gold Sponsor</i>
orbotech. The Language of Electronics
FPCコネクタ FPC connection co.,Ltd.
Meltex Link to X
<i>Silver Sponsor</i>
MacDermid Enthone ELECTRONICS SOLUTIONS

17. 広報活動 多方面に渡る露出を実施し、来場者数増加を達成！

(1) 日経BP・ITMedia等、大手メディア媒体の広告出稿を実施 新たな試みとして、以下の媒体への露出を実施。

- 日経BPターゲティングメール発送
日経ものづくり関東圏内購読者**3,500**件を対象に、招待状の発送を実施
- ITMedia モノづくり総合版 メールマガジン
Special版メール(100行)を**74,000**件宛に1回、ヘッダー広告を**84,000**件宛に2回配信
- EE Times Japan WEBバナー
Wスーパーバナーを会期前2週間に渡って掲載



※その他広告出稿媒体は(7) 広告掲載媒体にて記載。

(2) プレスリリース配信／インタビュー記事掲載

- プレスリリース配信
 - ① 11月18日(水) 出展早期申込割引日延長のお知らせ
 - ② 5月25日(水) 第12回JPCA賞(アワード)受賞企業の決定
 - ③ 5月25日(水) 第1回JPCA奨励賞受賞企業の決定
- インタビュー記事掲載
 - ① 3月3日(木) 電子デバイス産業新聞に展示会運営委員長のインタビュー記事掲載
 - ② 5月10日(火) 日本鍍金新報にJPCA Show 2016特集記事掲載
 - ③ 5月26日(木) 電子デバイス産業新聞にJPCA Show 2016記事掲載
 - ④ 5月26日(木) ≪プラチナスポンサー特典≫電子デバイス産業新聞に日本メクトロン(株)様のインタビュー記事掲載



●電子デバイス産業新聞
掲載日：3月3日



●電子デバイス産業新聞 掲載日：5月26日

(3) グローバル／海外展示会出展実績

- 7ヶ国の展示会に出展し、PR活動を実施した。
- ・2015年 8月20日(木)～22日(土) インド：IPCA Expo
 - ・2015年10月21日(水)～23日(金) 台湾：TPCA Show
 - ・2015年12月2日(水)～4日(金) 香港：HKPCA & IPC Show
 - ・2016年 3月15日(火)～17日(木) 中国：CPCA Show
 - ・2016年 3月15日(火)～17日(木) 米国：IPC APEX Expo
 - ・2016年 4月19日(火)～22日(金) タイ：LED & PCB Expo
 - ・2016年 4月26日(火)～28日(木) 韓国：KPCA Show

(4) 展示会公式サイト

年間を通じて様々な情報をリアルタイムに配信した。公式サイトでは、出展者情報を始め、各種情報を集約した他、来場者事前登録、基調講演／特別講演／パネルディスカッション・JIEP最先端実装技術シンポジウム聴講登録も実施した。本年は、ビジネスマッチング登録も開始し、出展者・来場者向けの情報発信を効果的に行った。

- 閲覧者数(ページビュー)
327,754PV(4月～会期までの約2ヶ月間)
※ページビューとは、ウェブサイトがどのくらい閲覧されているかを測るための指数のことをいう。
- 来場事前登録者数
11,583名(4月下旬～会期までの約1ヵ月間)

(5) オフィシャルメールマガジン

過去の来場者約**15**万件を対象に配信。

(6) PRツール製作及び配付

- 国内用招待状**280,000**部、海外用招待状**34,000**部、VIP招待券**40,000**部、ポスター**1,500**枚を作成し、出展者・主催／共催団体・協賛団体、過去来場者を中心に配布した。
- 公式ガイドブック「カンファレンスガイド」「フロアマップ(和英)」を作成し、会期中を通じ、全来場者・出展者に向けて配布した。



(7) 広告掲載媒体

電子機器トータルソリューションの見どころやセミナー情報等、15広告媒体に掲載された。

JPCA NEWS／エレクトロニクス実装技術／JARA機関紙／電子デバイス産業新聞／日経産業新聞／化学工業日報／インコム／DMカード／電波新聞／日刊工業新聞／月刊EMC／オートメーション新聞／産経新聞／メクトロニクス／プリント回路ジャーナル／日本鍍金新報



18. 2016年展示会主催・運営委員会 委員

2016展示会運営委員会 委員リスト

- 委員長 山本 治彦
(JPCA 副会長 / 超高効率電子回路生産システム研究会)
- 副委員長 児嶋 一登
(JPCA 理事 / (株)京写)
- 松岡 昇
(JPCA 理事 / ピアメカニクス(株))
- 委員 猪川 幸司
(JIEP 展示会事業委員会委員長 / 日本シイエムケイ(株))
- 太田 裕之
(JISSO PROTEC 2016 運営委員会委員長 / ヤマハ発動機(株))
- 泉谷 渉
(ラージエレクトロニクスショー 共催会社代表 / (株)産業タイムズ社)
- 井上 政基
(WIRE Japan Show 共催会社代表 / (株)工業通信)

展示会企画委員会 委員リスト

- 委員長 山本 治彦 (JPCA 副会長)
- 副委員長 ジュリアン・ベイショア (JPCA 理事 / 日本マクダーミッド(株))
- 委員 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
- 泉谷 渉 (株)産業タイムズ社)
- 内田 幸一 (日本オルボテック(株))
- 岡 謙吾 (株)工業通信)
- 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
- 熊谷 立人 (ヤマハ発動機(株))
- 小岩 一郎 (関東学院大学)
- 後藤 哲朗 (株)ニコン)
- 松本 博文 (日本メクトロン(株))

JPCA 活性化委員会 委員リスト

- 委員長 岩城 慶太郎 (メルテックス(株))
- 副委員長 兼子 昌和 (日本メクトロン(株))
- 委員 高見澤 栄治 (ソマール(株))

JIEP 展示会事業委員会 委員リスト

- 委員長 猪川 幸司 (日本シイエムケイ(株))
- 副委員長 高野 希 (日立化成(株))

最先端実装技術シンポジウム WG

- 委員長 小日向 茂 (大阪大学)
- 委員 土門 孝彰 (TDK(株))
- 齊藤 雅之 (株)東芝)
- 西田 秀行 (ニシダエレクトロニクス実装技術支援)
- 宝蔵寺 裕之 (株)日立製作所)
- 越地 福朗 東京工芸大学)
- 松原 孝宏 (京セラ(株))
- 本多 進 (C-NET)
- 和嶋 元世 (C-NET)
- 田畑 晴夫 (大阪大学)
- 三宅 敏広 (株)デンソー)
- 渡邊 裕彦 (富士電機(株))
- 伊藤 寿浩 (東京大学)
- 平田 勝子 (霞テクノロジー)
- 茨木 修 (C-NET)

アカデミックプラザ WG

- 委員長 小岩 一郎 (関東学院大学)
- 副委員長 白石 洋一 (群馬大学)
- 委員 澤田 廉士 (九州大学)
- 内木場 文男 (日本大学)

JISSO PROTEC 2016 運営委員会

- 委員長 太田 裕之 ヤマハ発動機(株)
- 副委員長 富士原 寛 (一社)日本ロボット工業会)
- 委員 永嶋 弘和 JUKI(株)
- 青田 広幸 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)
- 曾我 信之 富士機械製造(株)

JISSO PROTEC 2016 実行委員会

- 委員長 熊谷 立人 ヤマハ発動機(株)
- 副委員長 西村 勤 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)
- 委員 上田 裕司 JUKIオートメーションシステムズ(株)
- 今井 美津男 富士機械製造(株)
- 角屋敷 敏丸 千住金属工業(株)
- 榊 寿光 マイクロニックテクノロジー(株)
- 生島 直俊 武蔵エンジニアリング(株)
- 矢内 重章 (一社)日本ロボット工業会)

JISSO PROTEC 2016 企画部会 委員リスト

- 部会長 熊谷 裕司 ヤマハ発動機(株)
- 副部会長 西村 勤 パナソニック ファクトリーソリューションズ(株)
- 委員 上田 裕司 JUKIオートメーションシステムズ(株)
- 今井 美津男 富士機械製造(株)

世界唯一にして最大規模! 産学連携開催 電子回路関連産業展
電子機器トータルソリューション展
The Total Solution Exhibition for Electronic Equipment

次回開催決定!

2017 **6.7** Wed. ▶ **6.9** Fri.

東京ビッグサイト 東4-8ホール
Tokyo Big Sight, Japan
East 4-8 Hall

出展者募集中! 詳しくは事務局まで。
Book your booth now!

JPCA 2017 Show
47th International Electronic Circuits Exhibition
Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association

PLB Tech 2017
2017 フロント配線板技術展

EMS JAPAN 2017
2017 備前・半導体受託生産システム展

Module JAPAN 2017
2017 半導体パッケージ・部品内蔵技術展

夢をカタチに
次世代アプリア開発支援技術展

JIEP 2017 Microelectronics Show
31st ADVANCED ELECTRONICS PACKAGING EXHIBITION
Sponsored by: Japan Institute of Electronics Packaging

JISSO PROTEC 2017
19th Jisso Process Technology Exhibition
Sponsored by: Japan Robot Association (JARA)

Large Electronics Show 2017
Co-Sponsored by:
JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
Electronic Device Industry News (Sangyo Times, Inc.)

WIRE Japan Show 2017
Electric wire, Cable, and Connector Exhibition
Co-Sponsored by: JPCA-Japan Electronics Packaging and Circuits Association
THE ELECTRIC WIRE & CABLE NEWS (KOGYO TSUSHIN CO., LTD.)

詳細は展示会ウェブサイトへ▶ <http://www.jpcaashow.com/>

▶ お問い合わせ先 展示会運営事務局: 株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp

本部事務局:
一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2F
TEL: 03-5310-2020 FAX: 03-5310-2021 E-mail: show@jpca.org

展示会運営事務局:
株式会社JTBコミュニケーションデザイン
〒105-8335 東京都港区芝3-23-1 セレスティン芝三井ビルディング
TEL: 03-5657-0767 FAX: 03-5657-0645 E-mail: jpcashow@jtbcom.co.jp